

BC35-G-OpenCPU

硬件设计手册

LPWA 模块系列

版本: BC35-G-OpenCPU_硬件设计手册_V1.0

日期: 2019-06-26

状态: 受控文件



上海移远通信技术股份有限公司始终以为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨。如需任何帮助，请随时联系我司上海总部，联系方式如下：

上海移远通信技术股份有限公司

上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期（B 区）5 号楼 邮编：200233

电话：+86 21 51086236 邮箱：info@quectel.com

或联系我司当地办事处，详情请登录：

<http://www.quectel.com/cn/support/sales.htm>

如需技术支持或反馈我司技术文档中的问题，可随时登陆如下网址：

<http://www.quectel.com/cn/support/technical.htm>

或发送邮件至：support@quectel.com

前言

上海移远通信技术股份有限公司提供该文档内容用以支持其客户的产品设计。客户须按照文档中提供的规范、参数来设计其产品。由于客户操作不当而造成的人身伤害或财产损失，本公司不承担任何责任。在未声明前，上海移远通信技术股份有限公司有权对该文档进行更新。

版权申明

本文档版权属于上海移远通信技术股份有限公司，任何人未经我司允许而复制转载该文档将承担法律责任。

版权所有 ©上海移远通信技术股份有限公司 2019，保留一切权利。

Copyright © Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. 2019.

文档历史

修订记录

版本	日期	作者	变更表述
1.0	2019-06-26	鲁义文	初始版本

目录

文档历史	2
目录	3
表格索引	5
图片索引	6
1 引言	7
1.1. 安全须知	7
2 综述	8
2.1. 主要性能	9
2.2. 功能框图	10
2.3. 评估板	11
3 应用接口	12
3.1. 引脚分配	13
3.2. 引脚描述	14
3.3. 工作模式	18
3.4. 省电模式 (PSM)	18
3.5. 电源设计	19
3.5.1. 引脚介绍	19
3.5.2. 供电参考电路	19
3.6. 开机/关机	20
3.6.1. 开机	20
3.6.2. 关机	21
3.6.3. 复位模块	21
3.7. 串口	22
3.7.1. 主串口	24
3.7.2. 辅助串口	24
3.7.3. 调试串口	25
3.7.4. 串口应用	26
3.8. SPI 接口	27
3.9. I2C 接口	29
3.10. USIM 接口	29
3.11. 模数转换接口	30
3.12. 数模转换接口*	31
3.13. RI 信号	31
3.14. 网络状态指示	32
4 天线接口	34
4.1. 射频天线参考电路	34
4.2. 射频信号线 Layout 参考指导	35
4.3. RF 输出功率	36
4.4. RF 接收灵敏度	37
4.5. 工作频率	38

4.6.	天线要求	38
4.7.	安装天线时推荐使用的 RF 天线连接器	39
5	电气性能和可靠性	41
5.1.	绝对最大值	41
5.2.	工作和存储温度	41
5.3.	耗流	42
5.4.	静电防护	42
6	机械尺寸	44
6.1.	模块机械尺寸	44
6.2.	推荐封装	46
6.3.	模块俯视图/底视图	47
7	存储、生产和包装	48
7.1.	存储	48
7.2.	生产焊接	48
7.3.	包装	50
8	附录 A 参考文档及术语缩写	52
9	附录 B 复用引脚及其功能	54

表格索引

表 1: BC35-G-OPENCPU 模块支持的频段	8
表 2: 模块主要性能	9
表 3: I/O 参数定义	14
表 4: 引脚描述	14
表 5: 工作模式	18
表 6: VBAT 引脚和地引脚	19
表 7: 复位引脚描述	21
表 8: 串口引脚定义	22
表 9: 串口逻辑电平	23
表 10: 主串口特性参数	23
表 11: SPI 接口引脚定义	28
表 12: I2C 接口引脚定义	29
表 13: USIM 接口引脚定义	29
表 14: 模数转换接口引脚定义	31
表 15: 数模转换接口引脚定义	31
表 16: RI 信号状态	31
表 17: NETLIGHT 的工作状态	32
表 18: RF 天线引脚定义	34
表 19: RF 传导功率（上行 QPSK 和 BPSK 调制）	36
表 20: 单传下的传导灵敏度（THROUGHPUT \geq 95%）	37
表 21: 128 次重传下的 RF 传导灵敏度（THROUGHPUT \geq 95%）	37
表 22: 模块工作频率	38
表 23: 天线插入损耗要求	38
表 24: 天线参数	38
表 25: 绝对最大值	41
表 26: 工作和存储温度范围	41
表 28: 模块耗流	42
表 28: ESD 性能参数（温度：25 °C，湿度：45 %）	43
表 29: 推荐的炉温测试控制要求	49
表 30: 参考文档	52
表 31: 术语缩写	52
表 32: 多路复用引脚及其功能	54

图片索引

图 1: 功能框图	11
图 2: 引脚分配图	13
图 3: 功耗参考示意图	18
图 4: VBAT 输入端参考电路	20
图 5: 开机时序	20
图 6: 关机时序	21
图 7: 开集驱动参考复位电路	22
图 8: 按键复位参考电路	22
图 9: 主串口连接方式示意图	24
图 10: 辅助串口连接方式示意图	25
图 11: 软件调试连线示意图	25
图 12: 串口推荐电路	26
图 13: RS-232 电平转换电路	27
图 14: SPI 接口电平转换参考电路	28
图 15: 6-PIN 外部 USIM 卡座参考电路图	30
图 16: 收到 URC 信息或者短消息时 RI 时序	32
图 17: 网络状态指示参考电路	33
图 18: 射频天线参考电路	34
图 19: 两层 PCB 板微带线结构	35
图 20: 两层 PCB 板共面波导结构	35
图 21: 四层 PCB 板共面波导结构（参考地为第三层）	35
图 22: 四层 PCB 板共面波导结构（参考地为第四层）	36
图 23: U.FL-R-SMT 连接器尺寸（单位：毫米）	39
图 24: U.FL-LP 连接线系列	40
图 25: 安装尺寸（单位：毫米）	40
图 26: 俯视及侧视尺寸图	44
图 27: 底视尺寸图	45
图 28: 推荐封装	46
图 29: 模块俯视图	47
图 30: 模块底视图	47
图 31: 推荐的回流焊温度曲线	49
图 32: 卷带尺寸（单位：毫米）	50
图 33: 卷盘尺寸（单位：毫米）	51

1 引言

本文档定义了 BC35-G-OpenCPU 模块及其与客户应用连接的空中接口和硬件接口。

本文档可以帮助客户快速了解 BC35-G-OpenCPU 模块的硬件接口规范、电气特性、机械规范以及其他相关信息。通过此文档的帮助，结合移远通信的应用手册和用户指导书，客户可以快速应用 BC35-G-OpenCPU 模块于无线应用。

1.1. 安全须知

通过遵循以下安全原则，可确保个人安全并有助于保护产品和工作环境免遭潜在损坏。产品制造商需将如下的安全须知传达给终端用户。若未遵守这些安全规则，移远通信不会对用户错误使用而产生的后果承担任何责任。



道路行驶，安全第一！开车时请勿使用手持移动终端设备，即使其有免提功能。请先停车，再打电话！



登机前请关闭移动终端设备。在飞机上禁止开启移动终端的无线功能，以防止对飞机通讯系统的干扰。未遵守该提示项可能会影响飞行安全，甚至触犯法律。



出入医院或健康看护场所时，请注意是否存在移动终端设备使用限制。射频干扰可能会导致医疗设备运行失常，因此可能需要关闭移动终端设备。



移动终端设备并不保障任何情况下都能进行有效连接，例如在移动终端设备没有话费或(U)SIM 无效时。当你在紧急情况下遇见以上情况，请记住使用紧急呼叫，同时保证您的设备开机并且处于信号强度足够的区域。



移动终端设备在开机时会接收和发射射频信号。当靠近电视、收音机、电脑或者其他电子设备时都会产生射频干扰。



确保移动终端设备远离易燃易爆品。当靠近加油站、油库、化工厂或爆炸作业场所时，请关闭移动终端设备。在任何有潜在爆炸危险的场所操作电子设备均存在安全隐患。

2 综述

OpenCPU 是一种将模块作为主处理器的解决方案。随着通信技术的发展和市场需求的变化，越来越多的客户已经意识到 OpenCPU 解决方案的优势。特别是它在降低产品成本上的优势，使其备受行业用户的青睐。采用 OpenCPU 解决方案，可以简化用户对无线应用的开发流程，精简硬件结构设计，从而降低产品成本。OpenCPU 方案的主要特点如下：

- 快捷开发嵌入式应用，缩短产品开发周期
- 无需外部处理器、存储器及离散和相关的设计费用
- 缩小终端产品的实际尺寸
- 降低产品功耗
- 通过 DFOTA 远程升级固件
- 防拷贝技术增强产品的安全性
- 改善产品的市场性价比，提升产品竞争力

BC35-G-OpenCPU 是一款高性能、低功耗的 NB-IoT 模块，支持如下表格中所列的六个频段。通过 NB-IoT 无线电通信协议（3GPP Rel-14），BC35-G-OpenCPU 模块可与网络运营商的基础设备建立通信。

表 1：BC35-G-OpenCPU 模块支持的频段

频段	网络制式
Band 1	@H-FDD 2100MHz
Band 3	@H-FDD 1800MHz
Band 8	@H-FDD 900MHz
Band 5	@H-FDD 850MHz
Band 20	@H-FDD 800MHz
Band 28	@H-FDD 700MHz

BC35-G-OpenCPU 模块采用 LCC 贴片封装，并具有 23.6mm × 19.9mm × 2.2mm 的超小尺寸，便于嵌入到客户产品应用中，能满足物联网应用需求，例如：智能计量、共享单车、智能停车、智慧城市、安防、资产追踪、智能家电、农业和环境监测等。

模块采用了省电技术，功耗在省电模式（PSM）下，低至 3uA。

该模块完全符合欧盟 RoHS 标准。

2.1. 主要性能

下表详细描述了 BC35-G-OpenCPU 模块的主要性能。

表 2：模块主要性能

参数	说明
供电	<ul style="list-style-type: none"> VBAT 供电电压范围：3.1V~4.2V 典型供电电压：3.6V
省电	<ul style="list-style-type: none"> PSM 下典型耗流：3uA
发射功率	<ul style="list-style-type: none"> 23dBm±2dB
温度范围	<ul style="list-style-type: none"> 正常工作温度：-35°C ~ +75°C ¹⁾ 扩展工作温度：-40°C ~ +85°C ²⁾ 存储温度：-40°C ~ +90°C
USIM 接口	<ul style="list-style-type: none"> 支持 1.8V/3.0V 外部 Class B/C USIM 卡
eSIM	<ul style="list-style-type: none"> 内部预留 5*6mm MFF2 eSIM 封装
串口	<p>主串口：</p> <ul style="list-style-type: none"> 用于 AT 命令通信和数据传输，支持的波特率为 4800bps、9600bps（默认）、57600bps、115200bps、230400bps、460800bps 和 921600bps 用于固件升级，支持的波特率为 115200bps 和 921600bps <p>调试串口：</p> <ul style="list-style-type: none"> 用于软件调试 仅支持波特率 921600bps <p>辅助串口：</p> <ul style="list-style-type: none"> 用于数据传输，支持的波特率为 4800bps、9600bps、57600bps、115200bps、230400bps、460800bps 和 921600bps
网络协议特性	<ul style="list-style-type: none"> 支持 IPv4/IPv6/UDP/CoAP/LwM2M/Non-IP/DTLS/TCP/MQTT 协议
短信	<ul style="list-style-type: none"> PDU 模式 点对点 MO 和 MT
数据传输特性	<ul style="list-style-type: none"> Single-tone 传输，15kHz/3.75kHz 子载波间隔： 25.2kbps（下行），15.625kbps（上行） Multi-tone 传输，15kHz 子载波间隔： 25.2kbps（下行），54kbps（上行） Extended TBS/2 HARQ 传输，15kHz 子载波间隔： 125kbps（下行），150kbps（上行）

OTDOA	● 协议：3GPP Rel-14
ECID	● 协议：3GPP Rel-13
AT 命令	● 3GPP TS 27.007 V14.3.0 (2017-03) 定义的命令，以及移远通信增强型 AT 命令
物理特征	<ul style="list-style-type: none"> ● 尺寸：(23.6±0.15) mm × (19.9±0.15) mm × (2.2±0.2) mm ● 重量：1.8g±0.2g
固件升级	● 通过主串口或 DFOTA 升级
天线接口	● 50Ω 特性阻抗
RoHS	● 所有器件完全符合 EU RoHS 标准

备注

- 1) 当模块在此温度范围工作时，模块的相关性能满足 3GPP 标准要求。
- 2) 当模块在此温度范围工作时，模块仍能保持正常工作状态，具备短信、数据传输等功能；不会出现不可恢复的故障；射频频谱、网络基本不受影响。仅个别指标如输出功率等参数的值可能会超出 3GPP 标准的范围。当温度返回至正常工作温度范围时，模块的各项指标仍符合 3GPP 标准。

2.2. 功能框图

下图为 BC35-G-OpenCPU 功能框图，阐述了如下主要功能：

- 射频部分
- 基带部分
- 电源管理
- 外围接口

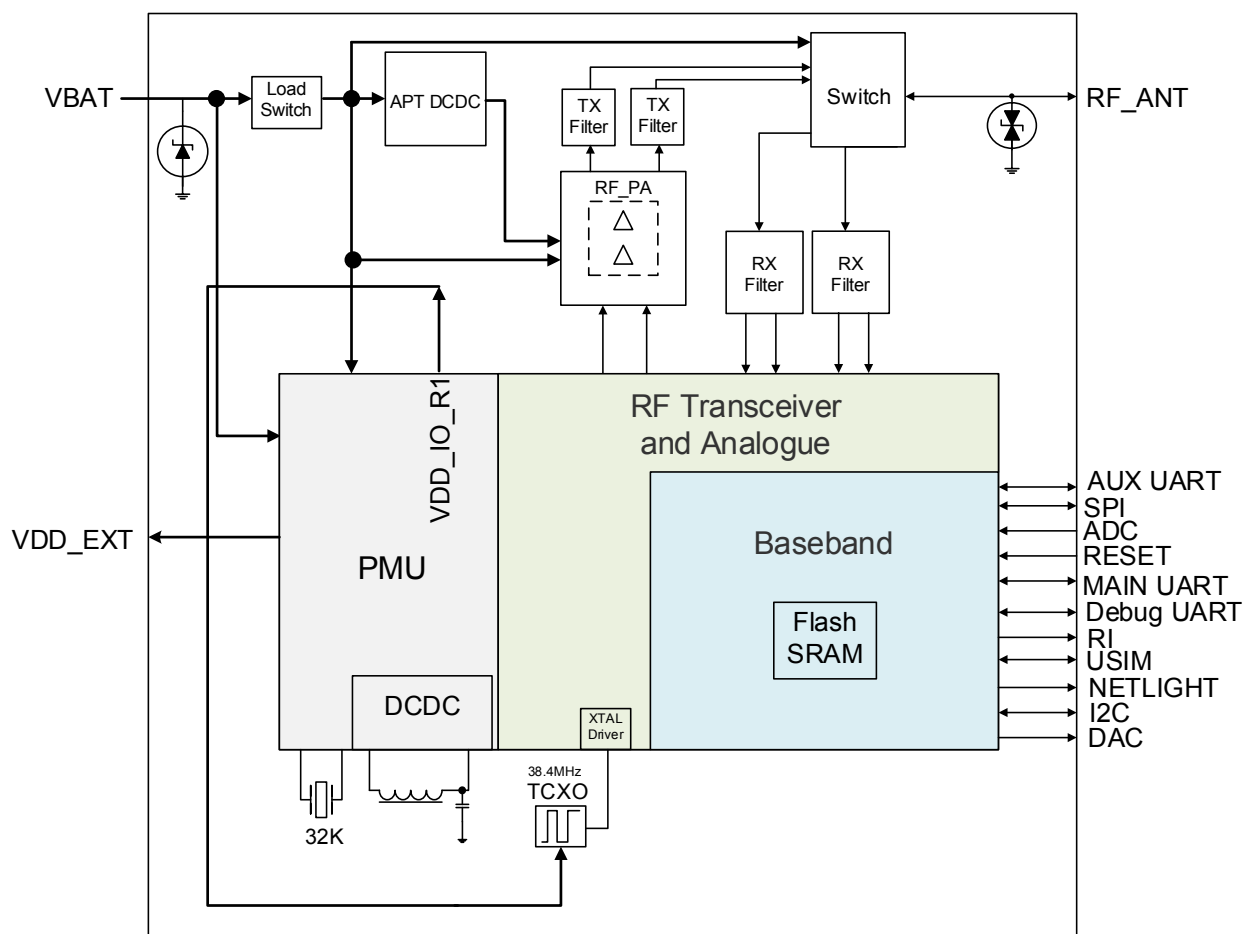


图 1：功能框图

2.3. 评估板

移远通信提供一整套评估板，以方便 BC35-G-OpenCPU 模块的测试和使用。所述评估板工具包括 TE-B 板、Micro USB 数据线、天线和其他外设。

3 应用接口

BC35-G-OpenCPU 模块共有 94 个引脚，其中 54 个为 LCC 引脚，其余 40 个为 LGA 引脚。后续章节详细阐述了模块各组接口的功能：

- 电源供电
- 串口
- SPI 接口
- I2C 接口
- USIM 接口
- 模数转换接口
- 数模转换接口*
- RI 信号接口
- 网络状态指示接口
- GPIO 接口

备注

“*” 表示正在开发中。

3.1. 引脚分配

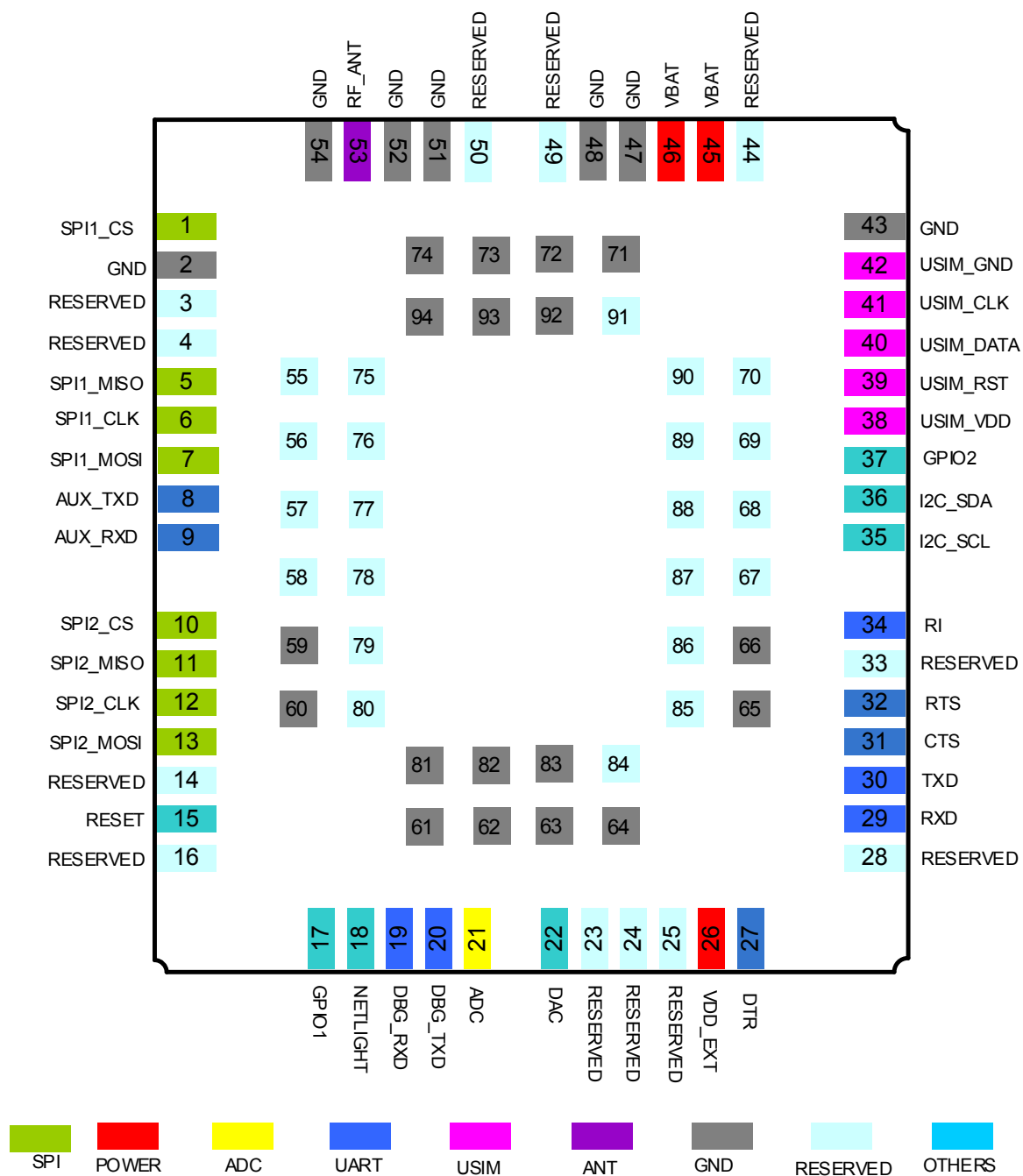


图 2：引脚分配图

3.2. 引脚描述

下表详细描述了 BC35-G-OpenCPU 模块的引脚定义。

表 3: I/O 参数定义

类型	描述
AI	模拟输入
AO	模拟输出
DI	数字输入
DO	数字输出
IO	双向端口
PI	电源输入
PO	电源输出

表 4: 引脚描述

电源					
引脚名	引脚号	I/O	描述	DC 特性	备注
VBAT	45、46	PI	模块电源 VBAT=3.1V~4.2V	Vmax=4.2V Vmin=3.1V Vnorm=3.6V	
VDD_EXT	26	PO	3.0V 输出电源	Vnorm=3.0V I _{Omax} =20mA (PSM 模式下为 1mA)	VDD_IO_R2, 建议用于外部 I/O 端口弱上拉, 并建议并联一个 2.2uF~4.7uF 的旁路电容。
GND	2、43、47、48、51、52、54、59~66、71~74、81~83、92~94		地		

开关机

引脚名	引脚号	I/O	描述	DC 特性	备注
RESET	15	DI	复位模块	$R_{PU} \approx 78k\Omega$ $V_{IHmax}=3.3V$ $V_{IHmin}=2.1V$ $V_{ILmax}=0.6V$	内部上拉。 低电平有效。

模块状态指示

引脚名	引脚号	I/O	描述	DC 特性	备注
NETLIGHT	18	DO	网络状态指示	$V_{OLmax}=0.3V$ $V_{OHmin}=2.4V$	VDD_IO_R2 电压域。 不用则悬空。

模数转换接口

引脚名	引脚号	I/O	描述	DC 特性	备注
ADC	21	AI	通用模数转换接口	电压范围： 0~4.0V	不用则悬空。 ADC 检测最大电压应小于电源输入电压。

数模转换接口*

引脚名	引脚号	I/O	描述	DC 特性	备注
DAC	22	AO	通用数模转换接口	电压范围： TBD	不用则悬空。

主串口

引脚名	引脚号	I/O	描述	DC 特性	备注
RXD	29	DI	从 DTE 设备 TXD 端接收数据	$V_{ILmax}=0.6V$ $V_{IHmin}=2.1V$ $V_{IHmax}=3.3V$ $V_{OLmax}=0.3V$ $V_{OHmin}=2.4V$	VDD_IO_R2 电压域；PSM 下，RXD 引脚不可悬空。
TXD	30	DO	发送数据到 DTE 设备的 RXD 端		
DTR	27	DI	DTE 准备就绪		
RI	34	DO	振铃提示（DCE 有 URC 输出或者短消息接收时会发送信号通知 DTE）		
CTS	31	DO	清除发送		
RTS	32	DI	DTE 请求发送		

调试串口

引脚名	引脚号	I/O	描述	DC 特性	备注
DBG_RXD	19	DI	模块调试串口接收数据	$V_{ILmax}=0.6V$ $V_{IHmin}=2.1V$ $V_{IHmax}=3.3V$	VDD_IO_R2 电压域。 不用则悬空。
DBG_TXD	20	DO	模块调试串口发送数据	$V_{OLmax}=0.3V$ $V_{OHmin}=2.4V$	

辅助串口

引脚名	引脚号	I/O	描述	DC 特性	备注
AUX_TXD	8	DO	发送数据到 DTE 设备的 RXD 端	$V_{OLmax}=0.3V$ $V_{OHmin}=2.4V$	VDD_IO_L1 电压域。使用此功能时，AUX_RXD 引脚不能悬空。
AUX_RXD	9	DI	从 DTE 设备 TXD 端接收数据	$V_{ILmax}=0.6V$ $V_{IHmin}=2.1V$ $V_{IHmax}=3.3V$	

SPI 接口

引脚名	引脚号	I/O	描述	DC 特性	备注
SPI1_CS	1	DO	片选信号	$V_{ILmax}=0.2*VDD_IO_L1$ $V_{IHmin}=0.7*VDD_IO_L1$ $V_{IHmax}=1.1*VDD_IO_L1$ $V_{OLmax}=0.1*VDD_IO_L1$ $V_{OHmin}=0.8*VDD_IO_L1$	VDD_IO_L1 电压域；不用则悬空。
SPI1_MISO	5	DI	主机输入从机输出信号		
SPI1_CLK	6	DO	串行时钟信号		
SPI1_MOSI	7	DO	主机输出从机输入信号		
SPI2_CS	10	DO	片选信号		
SPI2_MISO	11	DI	主机输入从机输出信号		
SPI2_CLK	12	DO	串行时钟信号		
SPI2_MOSI	13	DO	主机输出从机输入信号		

I2C 接口

引脚名	引脚号	I/O	描述	DC 特性	备注
I2C_SCL	35	DO	串行时钟线		VDD_IO_L1 电压域； 不用则悬空。
I2C_SDA	36	IO	串行数据线		

GPIO 接口

引脚名	引脚号	I/O	描述	DC 特性	备注
GPIO1	17	IO	GPIO		VDD_IO_R2 电压域。
GPIO2	37	IO	GPIO		

外部 USIM 接口

引脚名	引脚号	I/O	描述	DC 特性	备注
USIM_VDD	38	DO	外部 USIM 卡供电电压	Vnorm=1.8/3.0V	外部 USIM 卡接口建议使用 TVS 管进行 ESD 保护；外部 USIM 卡座到模块的布线最长不要超过 200mm。
USIM_RST	39	DO	外部 USIM 卡复位信号	VOLmax=0.1V*USIM_VDD VOHmin=0.8V*USIM_VDD	
USIM_DATA	40	IO	外部 USIM 卡数据信号	VOLmax=0.1V*USIM_VDD VOHmin=0.8V*USIM_VDD VILmin=-0.1V*USIM_VDD VILmax=0.2V*USIM_VDD VIHmin=0.7V*USIM_VDD VIHmax=1.1V*USIM_VDD	
USIM_CLK	41	DO	外部 USIM 卡时钟信号	VOLmax=0.1V*USIM_VDD VOHmin=0.8V*USIM_VDD	
USIM_GND	42		外部 USIM 卡专用地		

射频接口

引脚名	引脚号	I/O	描述	DC 特性	备注
RF_ANT	53	IO	射频天线焊盘		50Ω 特性阻抗

预留引脚

引脚名	引脚号	I/O	描述	DC 特性	备注
RESERVED	3、4、 14、16、 23~25、 28、33、 44、49、 50、 55~58、 67~70、 75~80、 84~91				保持悬空。

备注

1. 主串口的 DTR、CTS 和 RTS 引脚功能正在开发中。
2. VDD_IO_R2 和 VDD_IO_L1 为内置 PMU 输出电压域，可通过软件函数开启，VDD_IO_R2 默认开启。详细请参考文档 [6]。

3.3. 工作模式

下表简要地叙述了模块的三种工作模式。

表 5：工作模式

模式	功能
正常工作模式	Active 模块处于活动状态；所有功能正常可用，可以进行数据发送和接收。模块在此模式下可切换到 Idle 模式或 PSM 模式。
	Idle 模块处于浅睡眠状态，网络处于连接状态，可接受寻呼消息。模块在此模式下可切换至 Active 模式或者 PSM 模式。
	PSM 模块只有 RTC 工作，网络处于非连接状态，不可接受寻呼消息。当 DTE（Data Terminal Equipment）主动发送数据或者定时器 T3412（与周期性更新相关）超时后，模块将被唤醒。

3.4. 省电模式（PSM）

PSM 的主要目的是降低模块功耗，延长电池的供电时间。

下图显示了模块在不同模式下的功耗示意图。

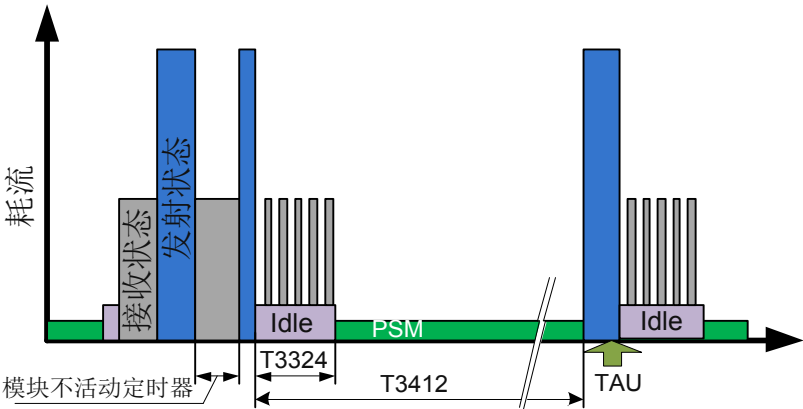


图 3：功耗参考示意图

模块进入 PSM 的过程如下：模块在与网络端建立连接或跟踪区更新（TAU）时，会在请求消息中申请进入 PSM，网络端在应答消息中配置 T3324 定时器数值返给模块，并启动可达定时器。当 T3324 定时器超时后，模块进入 PSM。模块在针对紧急业务进行连网或进行公共数据网络初始化时，不能申请进入 PSM。

当模块处于 PSM 模式时，将关闭连网活动，包括搜寻小区消息、小区重选等。但是 T3412 定时器（与周期性 TAU 更新相关）仍然继续工作。

模块退出 PSM 模式有两种方式：一种由 DTE 主动发送数据退出 PSM 模式，另一种是当 T3412 定时器超时后，TAU 启动，模块退出 PSM。

3.5. 电源设计

3.5.1. 引脚介绍

BC35-G-OpenCPU 有两个 VBAT 引脚用于连接外部电源。

如下表格描述了模块的 VBAT 引脚和地引脚。

表 6：VBAT 引脚和地引脚

引脚名	引脚号	描述	最小值	典型值	最大值	单位
VBAT	45、46	模块供电电源	3.1	3.6	4.2	V
GND	2、43、47、 48、51、52、 54、59~66、 71~74、81~83、 92~94	地		0		V

3.5.2. 供电参考电路

模块的电源设计对其性能至关重要。BC35-G-OpenCPU 可使用低静态电流、输出电流能力达到 0.8A 的 LDO 作为供电电源，也支持锂亚电池供电；其电源输入电压范围应为 3.1V~4.2V。模块在数传工作中，必须确保电源电压跌落不低于模块最低工作电压 3.1V。为了确保更好的电源供电性能，在靠近模块 VBAT 输入端，建议并联一个低 ESR 的 47uF 的钽电容，以及 100nF、100pF 和 22pF 滤波电容。同时，建议在靠近 VBAT 输入端增加一个 TVS 管以提高模块的浪涌电压承受能力，推荐使用 WS4.5DPV（关于 WS4.5DPV 的详细信息，请访问 <http://way-on.com/>）。原则上，VBAT 走线越长，线宽越宽。

VBAT 输入端参考电路如下图所示。

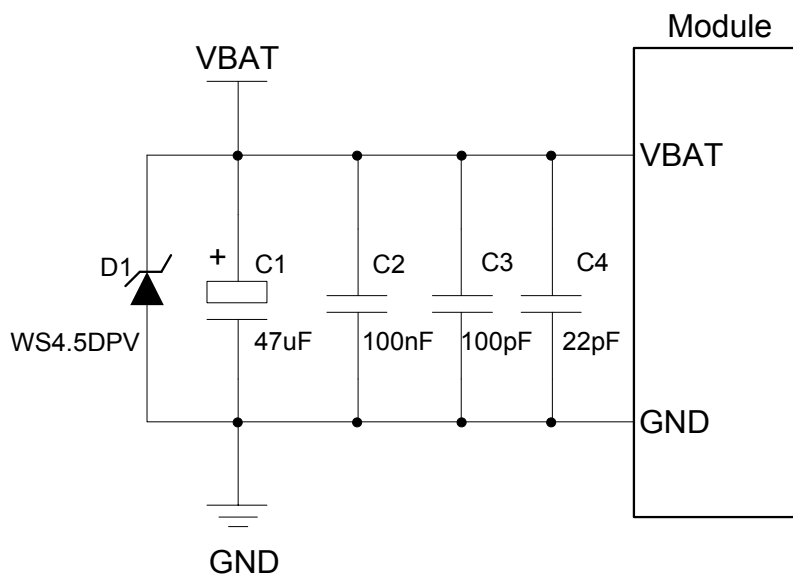


图 4: VBAT 输入端参考电路

3.6. 开机/关机

3.6.1. 开机

模块 VBAT 上电后，系统自动复位（需保持 RESET 高电平，默认内部上拉），实现模块开机。

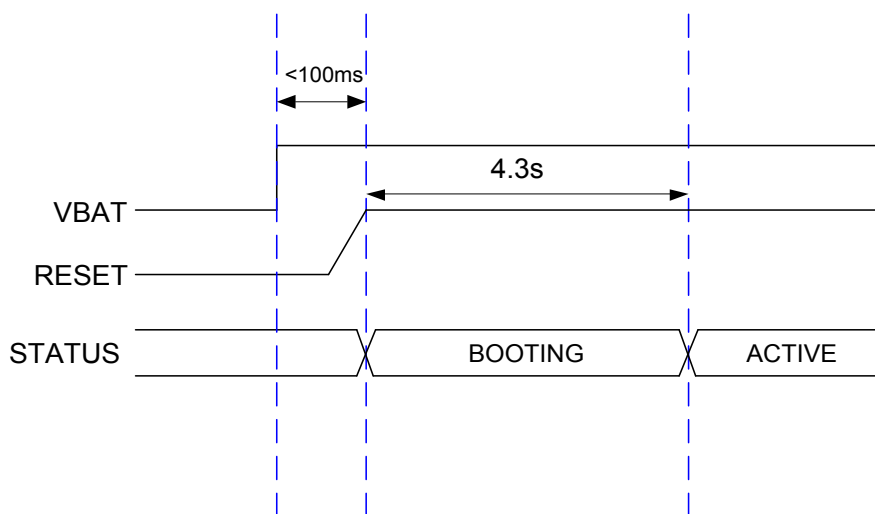


图 5: 开机时序

备注

- VBAT 上电后，RESET 由于内部上拉会自动上升为高电平。
- 启动过程中 RESET 信号不能拉低。

3.6.2. 关机

模块可以通过断开 VBAT 供电来实现关机。

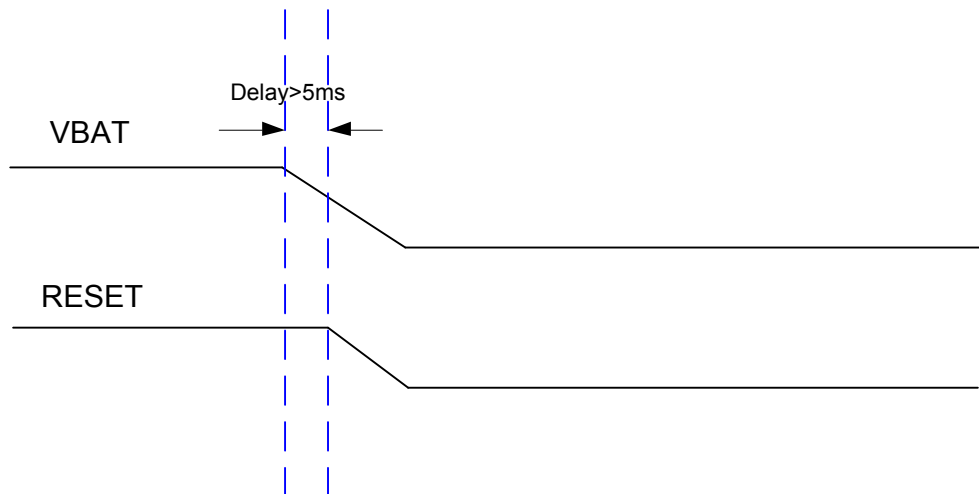


图 6：关机时序

3.6.3. 复位模块

模块可通过以下任意一种方式实现复位：

- 硬件复位：拉低复位引脚（RESET）100ms 以上可使模块复位；
- 软件复位：发送 **AT+NRB** 命令复位。详情请参照文档 [1]。

表 7：复位引脚描述

引脚名称	引脚号	描述	复位引脚拉低时间
RESET	15	复位模块，低电平有效	>100ms

硬件复位参考电路如下图所示。推荐使用开集驱动电路来控制 RESET 引脚。

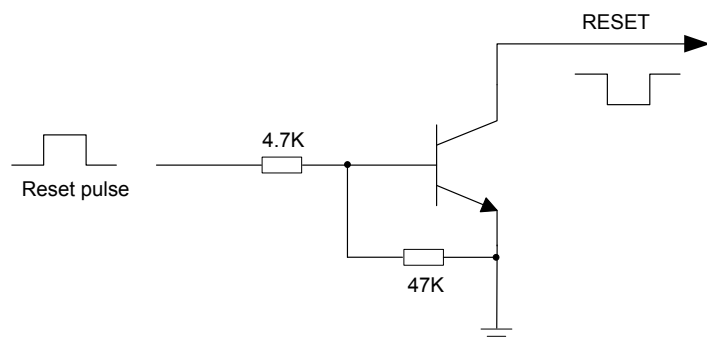


图 7：开集驱动参考复位电路

客户也可以使用按键控制 RESET 引脚。

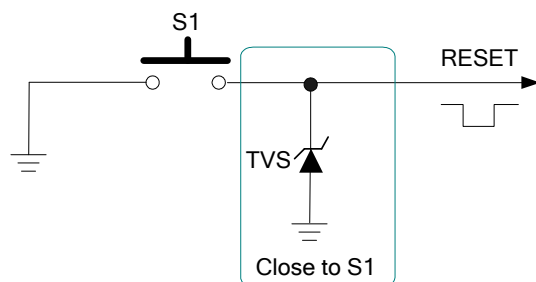


图 8：按键复位参考电路

3.7. 串口

模块设有三个串口：主串口，调试串口和辅助串口。模块作为 DCE（Data Communication Equipment），并按照传统的 DCE-DTE（Data Terminal Equipment）方式连接。

表 8：串口引脚定义

接口	引脚名称	引脚号	描述	备注
调试串口	DBG_RXD	19	模块调试串口接收数据	VDD_IO_R2电压域
	DBG_TXD	20	模块调试串口发送数据	
主串口	RXD	29	从 DTE 设备 TXD 端接收数据	

	TXD	30	发送数据到 DTE 设备的 RXD 端	
	DTR	27	DTE 准备就绪	
	RI	34	振铃提示（DCE 有 URC 输出或者短消息接收时会发送信号通知 DTE）	
	CTS	31	清除发送	
	RTS	32	DTE 请求发送	
辅助串口	AUX_TXD	8	模块辅助串口发送数据	VDD_IO_L1 电压域
	AUX_RXD	9	模块辅助串口接收数据	

备注

主串口的 DTR、CTS 和 RTS 引脚功能正在开发中。

表 9：串口逻辑电平

参数	最小值	最大值	单位
V_{IL}	$-0.1 \cdot V_{IO}$	$0.2 \cdot V_{IO}$	V
V_{IH}	$0.7 \cdot V_{IO}$	$1.1 \cdot V_{IO}$	V
V_{OL}		$0.1 \cdot V_{IO}$	V
V_{OH}	$0.8 \cdot V_{IO}$	V_{IO}	V

备注

1. 主串口及调试串口：VIO=VDD_IO_R2
2. 辅助串口：VIO=VDD_IO_L1
3. VDD_IO_R2 和 VDD_IO_L1 为内置 PMU 输出电压域，可通过软件函数开启，VDD_IO_R2 默认开启。详细请参考文档 [6]。

表 10：主串口特性参数

参数	描述
正常模式波特率	4800bps、9600bps、57600bps、115200bps、230400bps、460800bps、921600bps

PSM 模式波特率	4800bps、9600bps、57600bps
下载模式波特率	115200bps、921600bps
奇偶校验位	偶校验/奇校验/无校验
停止位数	1 bit 或 2 bits
每帧数据位数	8 bits

3.7.1. 主串口

主串口可用于 AT 命令传送和数据传输，支持的波特率为 4800bps、9600bps（默认）、57600bps、115200bps、230400bps、460800bps 和 921600bps。主串口为低功耗串口，在 Active、Idle 和 PSM 模式下均可工作，PSM 模式下仅支持 4800bps、9600bps（默认）、57600bps 波特率。它还可用于固件升级，支持的波特率为 115200bps 和 921600bps。更多有关固件升级的信息，请参考文档 [2]。

下图显示了主串口 DCE 和 DTE 之间的连接示意图。

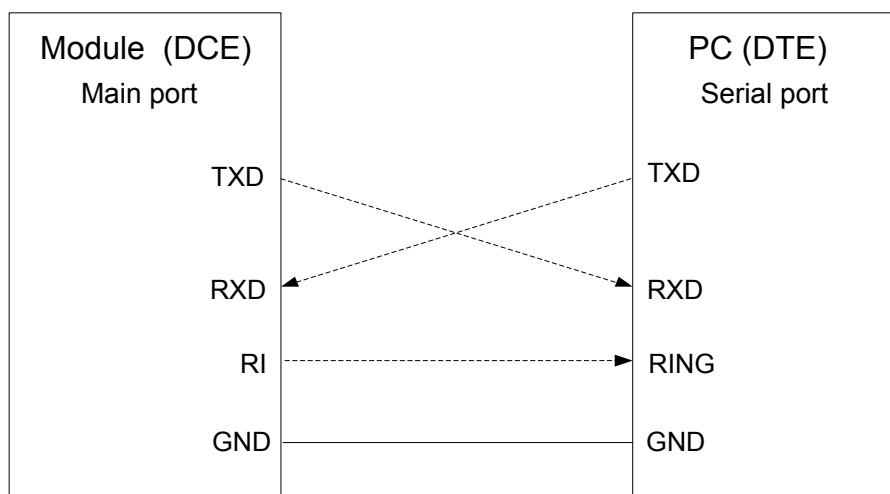


图 9：主串口连接方式示意图

3.7.2. 辅助串口

辅助串口支持的波特率为 4800bps、9600bps（默认）、57600bps、115200bps、230400bps、460800bps 和 921600bps。辅助串口只能在 ACTIVE 和 Idle 模式下工作，使用辅助串口需要开启 VDD_IO_L1 电压，请参考文档 [6]。

下图显示了辅助串口 DCE 和 DTE 之间的连接示意图。

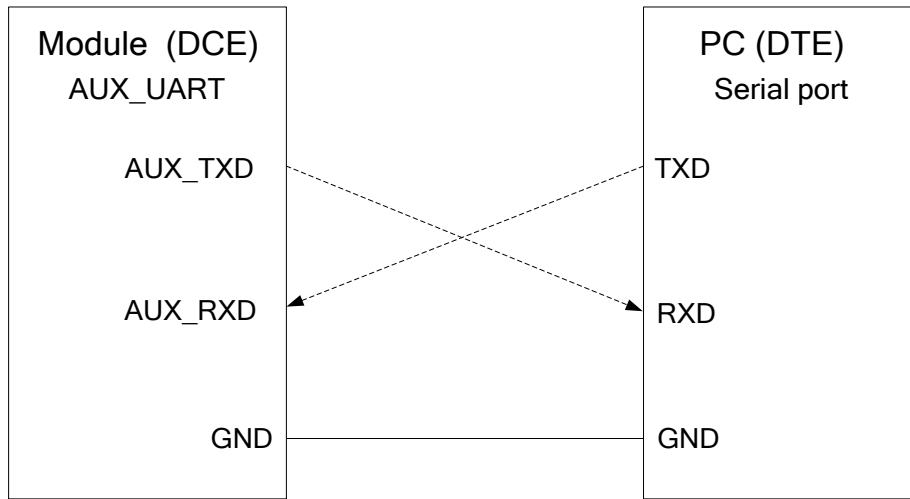


图 10：辅助串口连接方式示意图

3.7.3. 调试串口

通过 UEMonitor 日志查看工具，调试串口可用于查看日志信息以进行软件调试，其波特率为 921600bps。有关 UEMonitor 的使用信息，请参考文档 [3]。

调试串口的参考设计如下所示。

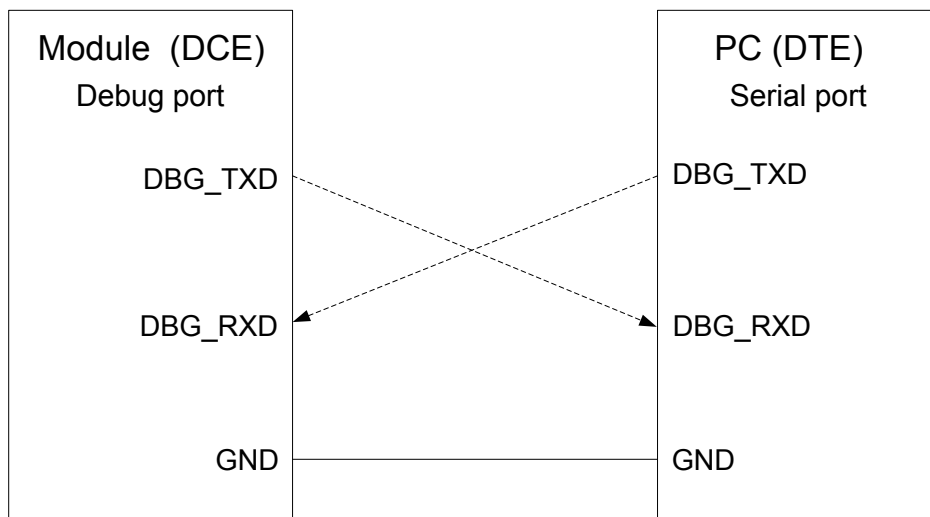


图 11：软件调试连线示意图

3.7.4. 串口应用

串口推荐电路如下。

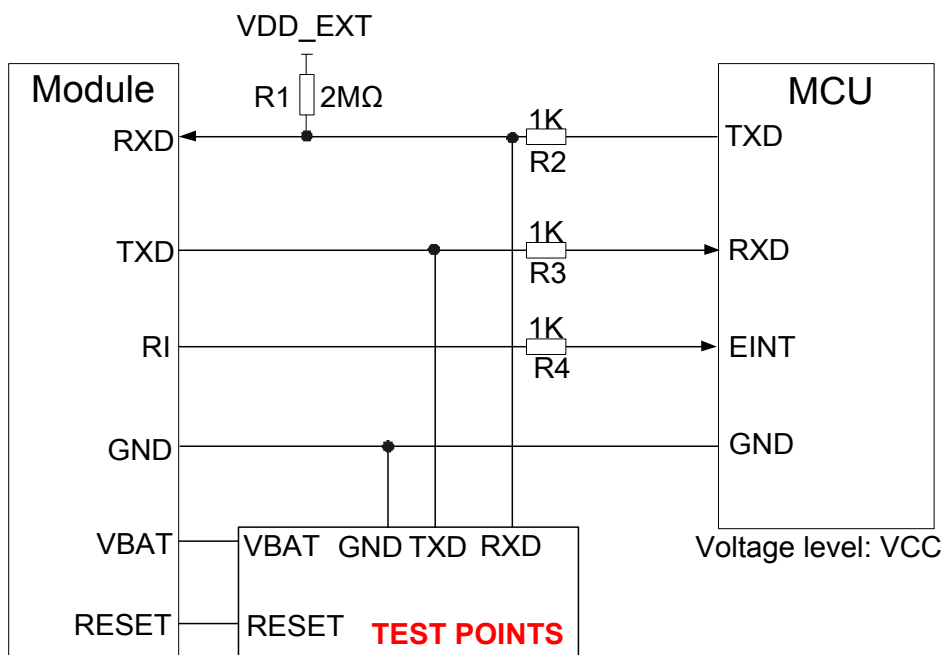


图 12: 串口推荐电路

备注

1. PSM 模式下，MCU_TXD 不能悬空，建议预留 2MΩ 电阻上拉到 VDD_EXT；
2. 如 $VCC > VDD_EXT$ ，建议将上拉电阻 R1 更改成 20kΩ，电阻 R2 更改成二极管（阴极指向 MCU_TXD），以减少 PSM 漏电；如 $VCC < VDD_EXT$ ，则建议使用额外的电平转换电路；
3. 当 $VCC > VDD_EXT$ ，PSM 模式下，MCU_RXD 建议配置成浮空输入（输入上拉或者下拉都容易造成漏电）；
4. 串口电平不匹配或模块 RXD 悬空，都容易造成 PSM 功耗偏高，请严格按照推荐电路进行设计；
5. 辅助串口电路，可参考主串口设计，需要参考文档 [6] 打开 VDD_IO_L1 电压，AUX_RXD 引脚不可悬空；
6. 建议预留 GND、TXD、RXD、RESET 和 VBAT 测试点以方便对系统进行固件升级。

下图是标准 RS-232 接口和模块之间的连接示意图。客户需要确保各器件间的电平匹配。

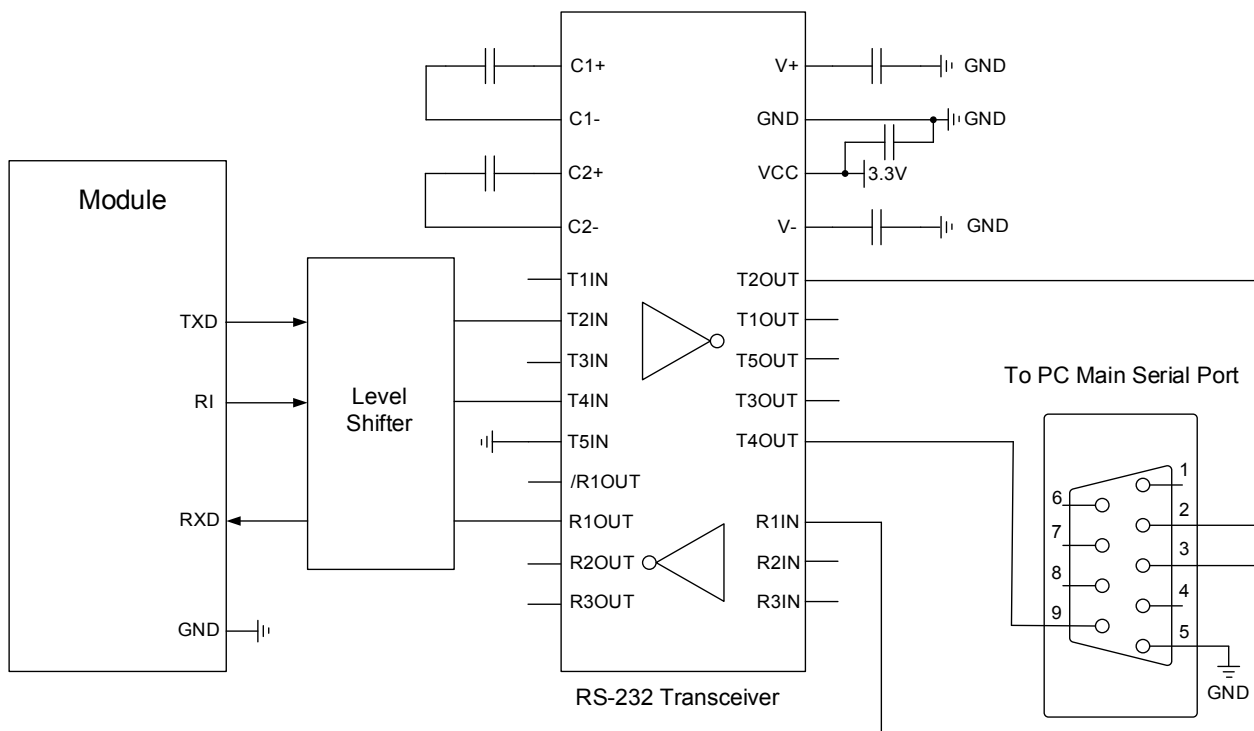


图 13: RS-232 电平转换电路

请访问供应商网站选择合适的 RS-232 电平转换芯片，如 <http://www.maximintegrated.com> 或 <http://www.exar.com>。

3.8. SPI 接口

模块默认开放两组 SPI 接口，仅支持主机模式（模块做主机），可用于指纹识别等设计，若用到此功能，请保持 VDD IO L1 开启。

该 SPI 接口使用同步全双工串行通信方式，其工作电压域为 VDD_IO_L1，时钟频率高达 24MHz。SPI 接口的主要特点如下：

- 支持主机模式
- 时钟频率可调节
- 串行时钟的极性和相位可调

下表列出了 SPI 接口的引脚定义：

表 11：SPI 接口引脚定义

引脚名称	引脚号	I/O	描述	备注
SPI1_CS	1	DO	片选信号	
SPI1_MISO	5	DI	主机输入从机输出信号	
SPI1_CLK	6	DO	串行时钟信号	
SPI1_MOSI	7	DO	主机输出从机输入信号	VDD_IO_L1 电压域
SPI2_CS	10	DO	片选信号	
SPI2_MISO	11	DI	主机输入从机输出信号	
SPI2_CLK	12	DO	串行时钟信号	
SPI2_MOSI	13	DO	主机输出从机输入信号	

该模块的 SPI 接口电压域为 VDD_IO_L1。若与从机系统电压域不匹配，则需在模块和从机之间增加电平转换器；推荐使用支持 SPI 数据速率的电平转换器。参考电路如下图所示：

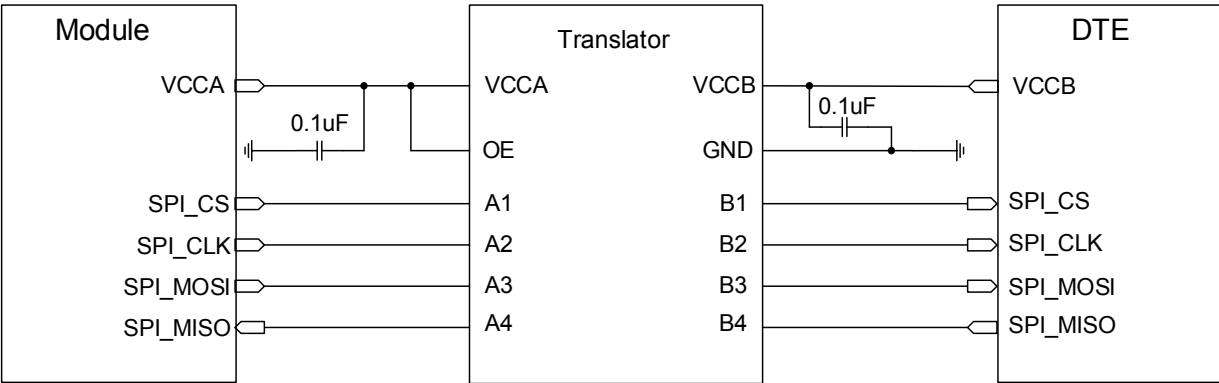


图 14：SPI 接口电平转换参考电路

备注

VCCA 匹配模块端 VDD_IO_L1 的电压，VCCB 匹配 DTE 端 SPI 接口电压。

3.9. I2C 接口

BC35-G-OpenCPU 可以提供一组 I2C 接口，主要特点如下：

- 支持 100kbps 标准模式
- 支持主机模式
- 时钟频率可调
- 支持 7 位寻址方式

表 12: I2C 接口引脚定义

引脚名称	引脚号	I/O	描述	备注
I2C_SCL	35	DO	串行时钟线	VDD_IO_L1 电压域，需要外接上拉电阻。
I2C_SDA	36	IO	串行数据线	

备注

VDD_IO_L1 为内置 PMU 输出电压域，可通过软件函数开启，请参考文档 [6]。

3.10. USIM 接口

模块包含一个 USIM 接口，支持模块访问外部 USIM 卡。该 USIM 接口支持 7816-3 协议的功能。

外部 USIM 卡通过模块内部的电源供电，支持 1.8V/3.0V 供电。

表 13: USIM 接口引脚定义

引脚名称	引脚号	描述
USIM_VDD	38	外部 USIM 卡供电电源。 1.8V/3.0V
USIM_CLK	41	外部 USIM 卡时钟信号
USIM_DATA	40	外部 USIM 卡数据信号
USIM_RST	39	外部 USIM 卡复位信号
USIM_GND	42	外部 USIM 卡专用地

下图是 6-pin 外部 USIM 卡座的参考设计。

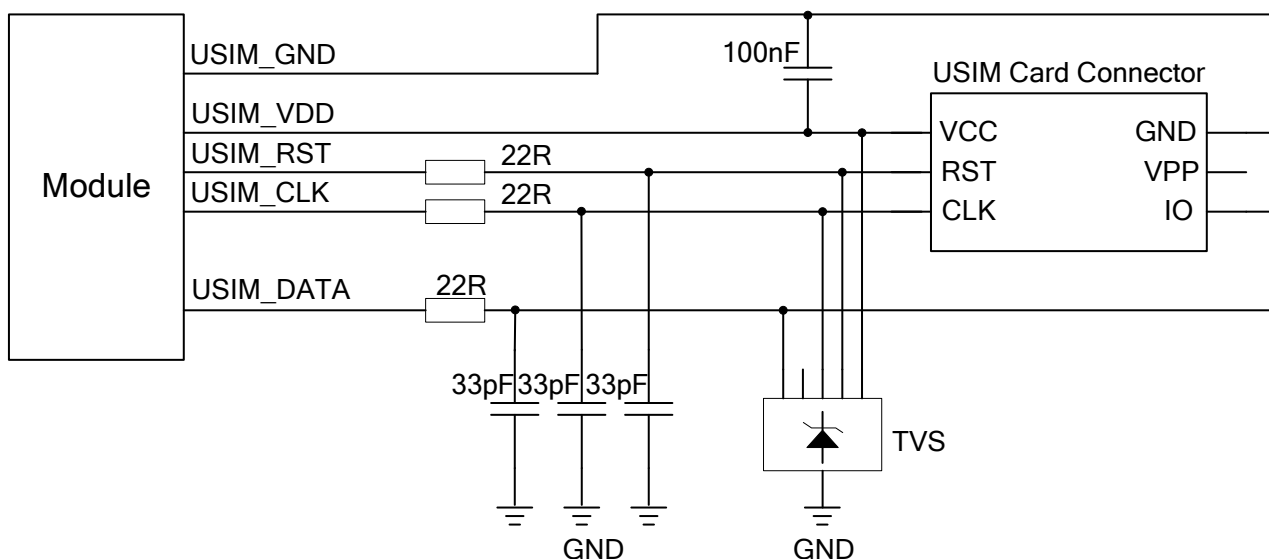


图 15: 6-pin 外部 USIM 卡座参考电路图

关于外部 USIM 卡座的选择，请访问网址 <http://www.amphenol.com> 和 <http://www.molex.com>。

在外部 USIM 接口的电路设计中，为确保外部 USIM 卡的性能良好并防止外部 USIM 卡被损坏，在电路设计中建议遵循以下设计原则：

- 外部 USIM 卡座靠近模块摆放，尽量保证外部 USIM 卡信号线布线长度不超过 200mm。
- 外部 USIM 卡信号线布线远离 RF 走线和 VBAT 电源线。
- 外部 USIM 卡座的地与模块的 USIM_GND 布线要短而粗。为保证相同的电势，需确保布线宽度不小于 0.5mm。USIM_VDD 的去耦电容不超过 1uF，且电容应靠近外部 USIM 卡座摆放。
- 为了防止 USIM_CLK 信号与 USIM_DATA 信号相互串扰，两者布线不能太靠近，并且在两条走线之间需增加地屏蔽。此外，USIM_RST 信号也需要地保护。
- 为确保良好的 ESD 防护性能，建议在外部 USIM 卡的引脚增加 TVS 管。选择的 TVS 管寄生电容应不大于 50pF，可以访问 <http://www.onsemi.com> 来选择合适的 TVS 器件。ESD 保护器件尽量靠近外部 USIM 卡座摆放，外部 USIM 卡信号走线应先从外部 USIM 卡座连到 ESD 保护器件再从 ESD 保护器件连到模块。在模块和外部 USIM 卡座之间需要串联 22Ω 的电阻用以抑制杂散 EMI，增强 ESD 防护。外部 USIM 卡的外围器件应尽量靠近外部 USIM 卡座摆放。
- 在 USIM_DATA、USIM_CLK 和 USIM_RST 线上并联 33pF 电容用于滤除射频干扰。

3.11. 模数转换接口

模块提供一个 10 位模数转换输入接口来测量电压值。该模数转换接口在 Active 和 Idle 模式下均可工作。

表 14: 模数转换接口引脚定义

引脚名称	引脚号	描述
ADC	21	通用模数转换接口

3.12. 数模转换接口*

模块提供一个 10 位数模转换接口，该数模转换接口在 **Active** 和 **Idle** 模式下均可工作。

表 15: 数模转换接口引脚定义

引脚名称	引脚号	描述
DAC	22	通用数模转换接口

备注

“*” 表示正在开发中。

3.13. RI 信号

模块 RI 引脚在收到短消息和 URC 上报时的指示信号如下：

表 16: RI 信号状态

模块状态	RI 信号状态
待机	高电平
短信	当收到短消息时，RI 输出低电平，持续时间至少 120ms，数据输出完成后再变为高电平。
URC	当收到 URC 信息上报时，RI 输出低电平，持续时间至少 120ms，数据输出完成后再变为高电平。

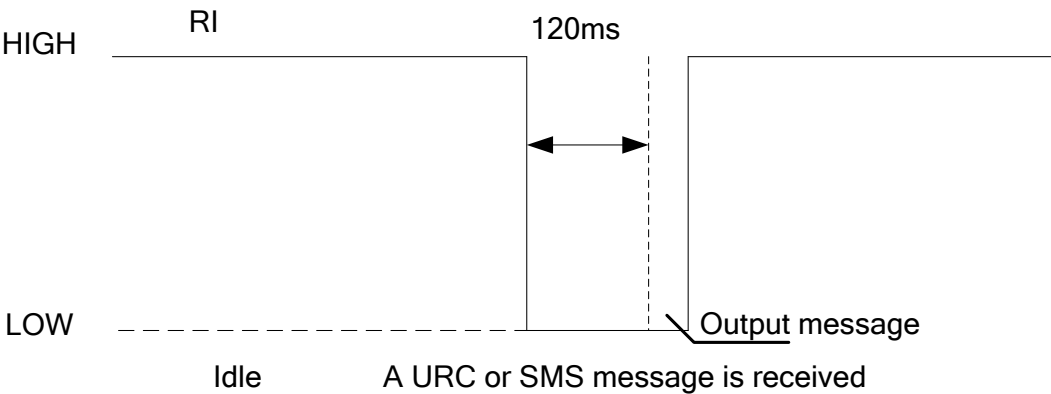


图 16: 收到 URC 信息或者短消息时 RI 时序

备注

当收到短信或者 URC 信息上报时，RI 先输出低电平 120ms，然后再输出数据；输出数据的过程 RI 也是低电平。RI 最大低电平时间取决于 URC 输出数据长度和串口波特率。

3.14. 网络状态指示

NETLIGHT 信号可以用来指示模块的网络状态，该功能默认关闭，NETLIGHT 引脚输出低电平。功能需要通过命令：**AT+QLEDMODE=1** 开启，该功能开启后 NETLIGHT 引脚工作状态如下表所示。

表 17: NETLIGHT 的工作状态

NETLIGHT 高低电平状态	模块工作状态
高电平 64ms（灯亮） / 低电平 800ms（灯灭）	模块正常启动后的找网状态
高电平 64ms（灯亮） / 低电平 2000ms（灯灭）	模块注册到网络且处于连接状态
持续低电平（灯灭）	模块处于其它状态时

NETLIGHT 指示灯的连接参考电路如下图所示。

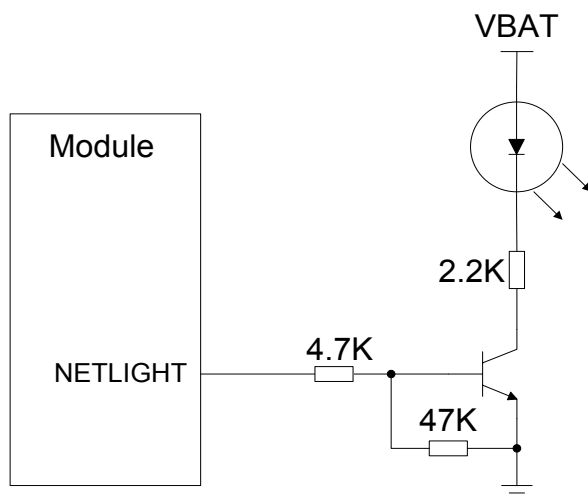


图 17：网络状态指示参考电路

4 天线接口

引脚 53 是模块的 RF 天线接口。RF 天线端口阻抗为 50Ω。

表 18: RF 天线引脚定义

引脚名称	引脚号	描述
GND	51、52、54	地
RF_ANT	53	RF 天线接口

4.1. 射频天线参考电路

对于天线接口的外围电路设计，为了能够更好地调节射频性能，建议预留 π 型匹配电路， π 型匹配电路元件应尽量靠近天线放置，且需要根据实际情况选贴。默认情况下，C1、C2 不贴，只在 R1 贴 0Ω 电阻。

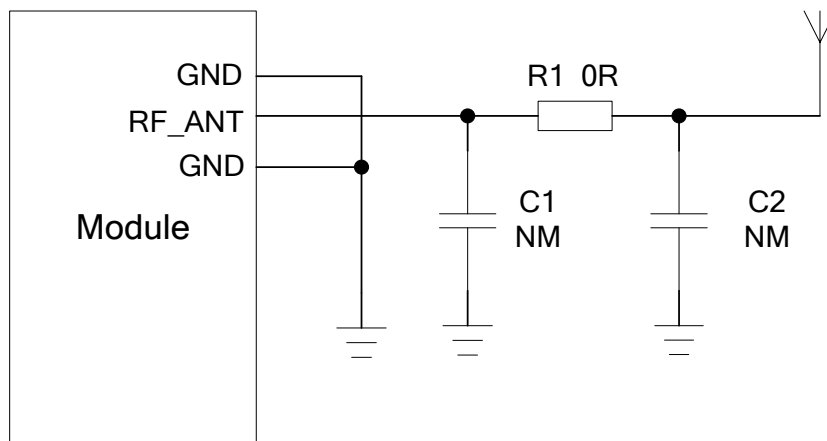


图 18: 射频天线参考电路

BC35-G-OpenCPU 提供了一个 RF 焊盘接口供连接外部天线。模块 RF 接口两侧都有接地焊盘，以获得更好的接地性能。

4.2. 射频信号线 Layout 参考指导

对于用户 PCB 而言，所有的射频信号线的特性阻抗应控制在 50Ω 。一般情况下，射频信号线的阻抗由材料的介电常数、走线宽度（W）、对地间隙（S）、以及参考地平面的高度（H）决定。PCB 特性阻抗的控制通常采用微带线与共面波导两种方式。为了体现设计原则，下面几幅图展示了阻抗线控制为 50Ω 时微带线以及共面波导的结构设计。

- 微带线完整结构

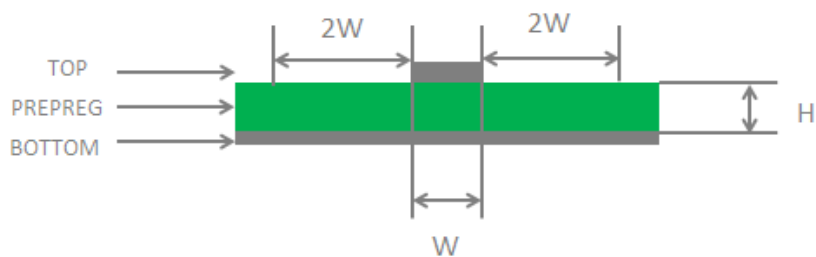


图 19：两层 PCB 板微带线结构

- 共面波导完整结构

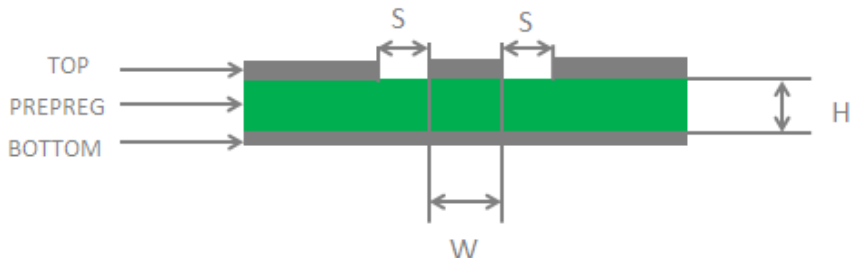


图 20：两层 PCB 板共面波导结构

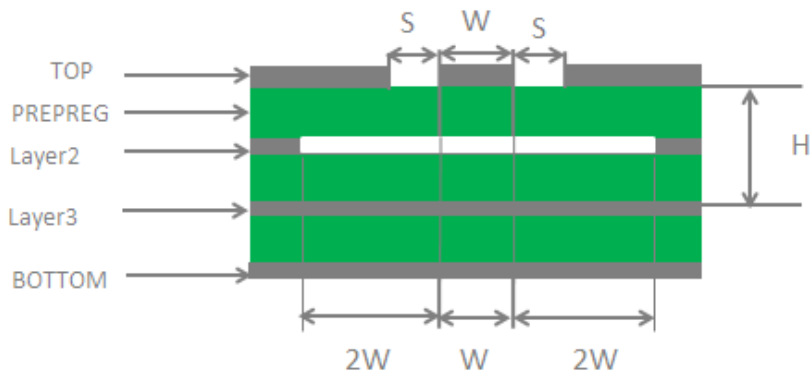


图 21：四层 PCB 板共面波导结构（参考地为第三层）

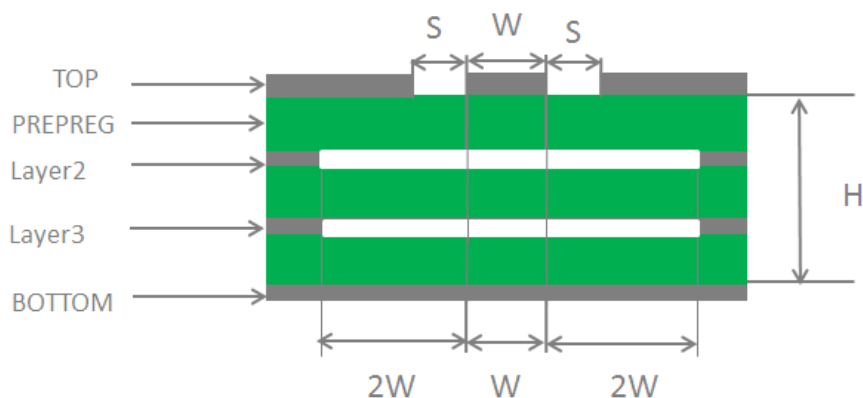


图 22: 四层 PCB 板共面波导结构（参考地为第四层）

在射频天线接口的电路设计中，为了确保射频信号的良好性能与可靠性，在电路设计中建议遵循以下设计原则：

- 应使用阻抗模拟计算工具对射频信号线进行精确的 50Ω 阻抗控制。
- 与射频引脚相邻的 GND 引脚不做热焊盘，要与地充分接触。
- 射频引脚到 RF 连接器之间的距离应尽量短；同时避免直角走线，建议的走线夹角为 135° 。
- 连接器件封装建立时要注意，信号脚离地要保持一定距离。
- 射频信号线参考的地平面应完整；在信号线和参考地周边增加一定量的地孔可以帮助提升射频性能；地孔和信号线之间的距离应至少为 2 倍线宽 ($2*W$)。

更多关于射频 Layout 的说明，请参考文档 [4]。

4.3. RF 输出功率

表 19: RF 传导功率（上行 QPSK 和 BPSK 调制）

频段	最大值	最小值
Band 1	$23\text{dBm} \pm 2\text{dB}$	$< -40\text{dBm}$
Band 3	$23\text{dBm} \pm 2\text{dB}$	$< -40\text{dBm}$
Band 8	$23\text{dBm} \pm 2\text{dB}$	$< -40\text{dBm}$
Band 5	$23\text{dBm} \pm 2\text{dB}$	$< -40\text{dBm}$
Band 20	$23\text{dBm} \pm 2\text{dB}$	$< -40\text{dBm}$

Band 28	23dBm±2dB	<-40dBm
---------	-----------	---------

备注

该设计符合 3GPP Rel-14 中的 NB-IoT 协议。

4.4. RF 接收灵敏度

表 20：单传下的传导灵敏度（Throughput ≥ 95%）

频段	接收灵敏度	3GPP 标准
Band 1	-112dBm	-107.5dBm
Band 3	-112dBm	-107.5dBm
Band 8	-114dBm	-107.5dBm
Band 5	-114dBm	-107.5dBm
Band 20	-114dBm	-107.5dBm
Band 28	-114dBm	-107.5dBm

表 21：128 次重传下的 RF 传导灵敏度（Throughput ≥ 95%）

频段	接收灵敏度
Band 1	-128dBm
Band 3	-128dBm
Band 8	-130dBm
Band 5	-130dBm
Band 20	-130dBm
Band 28	-130dBm

4.5. 工作频率

表 22: 模块工作频率

频段	接收频率	发射频率
Band 1	2110MHz~2170MHz	1920MHz~1980MHz
Band 3	1805MHz~1880MHz	1710MHz~1785MHz
Band 8	925MHz~960MHz	880MHz~915MHz
Band 5	869MHz~894MHz	824MHz~849MHz
Band 20	791MHz~821MHz	832MHz~862MHz
Band 28	758MHz~803MHz	703MHz~748MHz

4.6. 天线要求

下面表格罗列了对 NB-IoT 天线的参数需求。

表 23: 天线插入损耗要求

频率	损耗
703MHz~960MHz	插入损耗: <1dB
1710MHz~2200MHz	插入损耗: <1dB

表 24: 天线参数

参数	要求
频率	703MHz~960MHz; 1710MHz~2200MHz
VSWR	≤2
增益 (dBi)	≥1
最大输入功率 (W)	50

输入阻抗 (Ω)	50
极化类型	线极化

4.7. 安装天线时推荐使用的 RF 天线连接器

如果使用 RF 连接器进行天线连接，推荐使用 Hirose 的 U.FL-R-SMT 连接器。

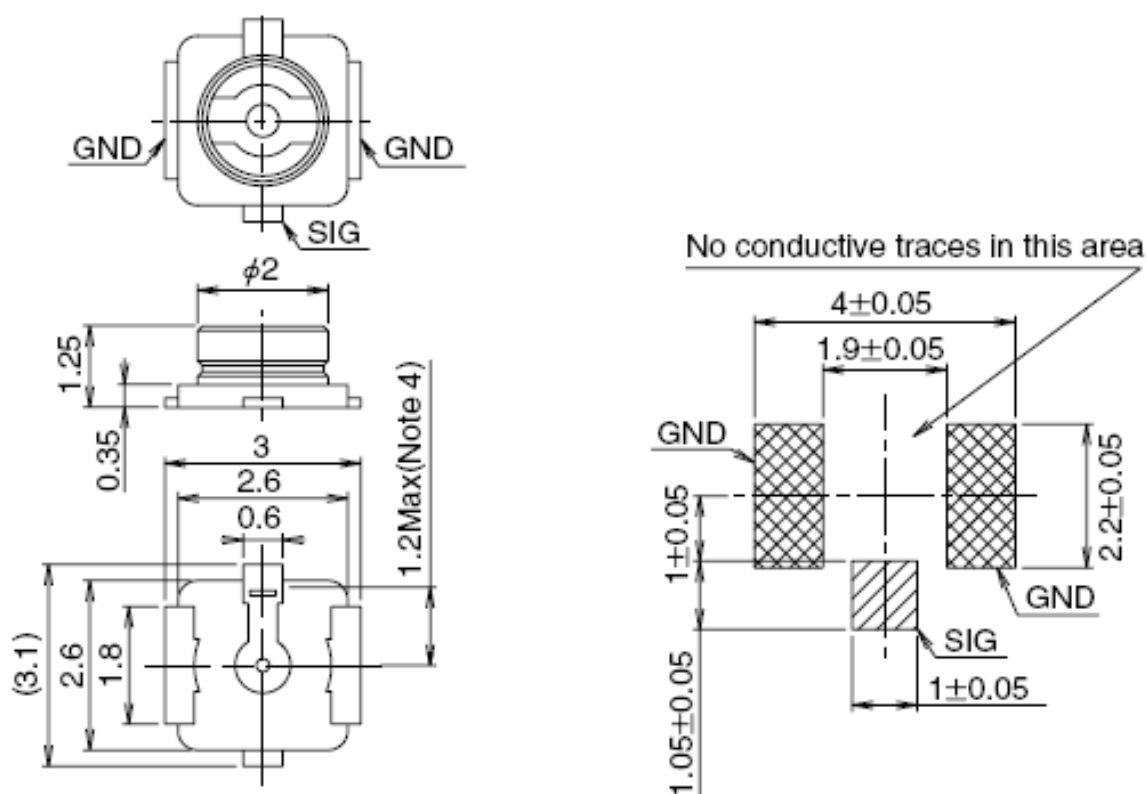


图 23: U.FL-R-SMT 连接器尺寸 (单位: 毫米)

可选择 U.FL-LP 系列的连接线来和 U.FL-R-SMT 配合使用。

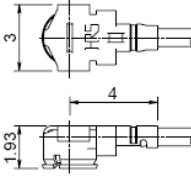
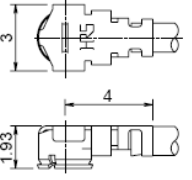
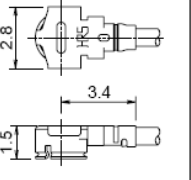
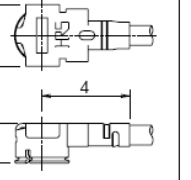
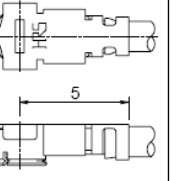
Part No.	U.FL-LP-040	U.FL-LP-066	U.FL-LP(V)-040	U.FL-LP-062	U.FL-LP-088
					
Mated Height	2.5mm Max. (2.4mm Nom.)	2.5mm Max. (2.4mm Nom.)	2.0mm Max. (1.9mm Nom.)	2.4mm Max. (2.3mm Nom.)	2.4mm Max. (2.3mm Nom.)
Applicable cable	Dia. 0.81mm Coaxial cable	Dia. 1.13mm and Dia. 1.32mm Coaxial cable	Dia. 0.81mm Coaxial cable	Dia. 1mm Coaxial cable	Dia. 1.37mm Coaxial cable
Weight (mg)	53.7	59.1	34.8	45.5	71.7
RoHS	YES				

图 24: U.FL-LP 连接线系列

下图为连接线和连接器安装尺寸:

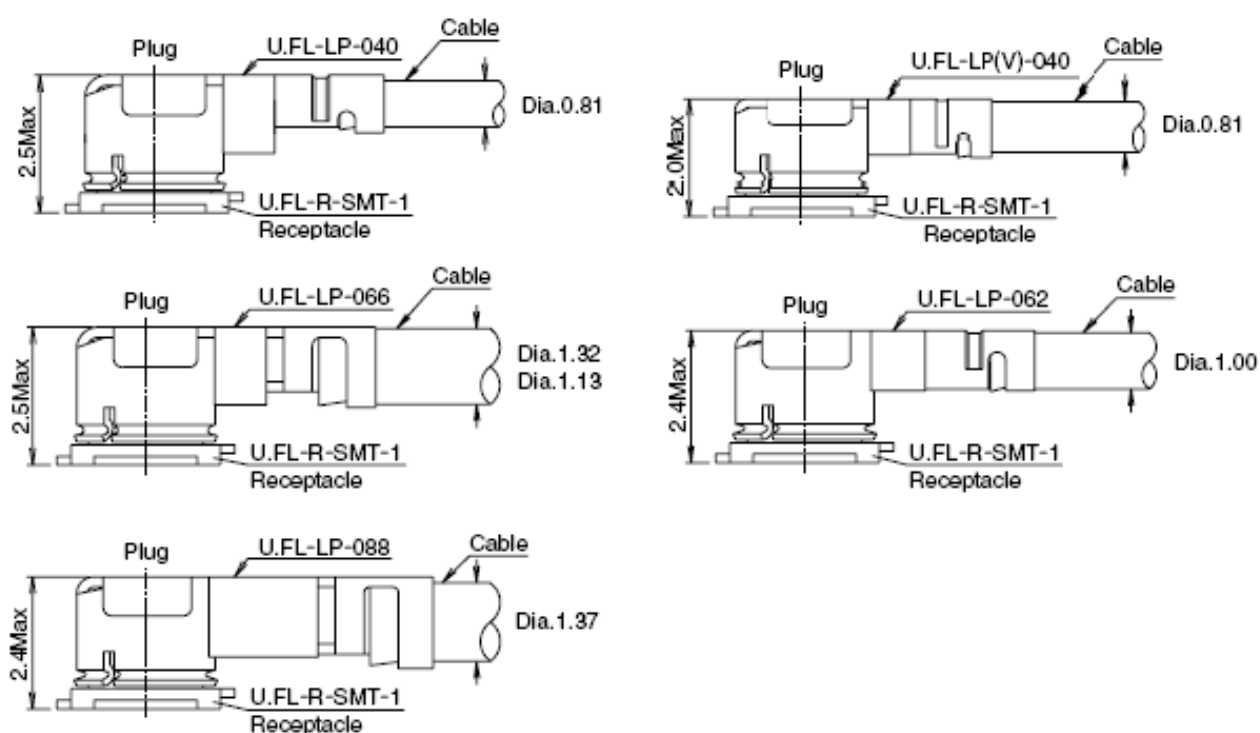


图 25: 安装尺寸 (单位: 毫米)

详细信息请访问 <http://www.hirose.com>。

5 电气性能和可靠性

5.1. 绝对最大值

下表所示是模块数字和模拟引脚的电源供电电压电流最大耐受值。

表 25: 绝对最大值

参数	最小值	最大值	单位
VBAT	-0.3	+4.25	V
极限电流	0	0.8	A
数字引脚处电压	-0.3	+4.25	V
模拟引脚处电压	-0.3	+4.25	V
关机模式下数字/模拟引脚处电压	-0.25	+0.25	V

5.2. 工作和存储温度

下表所示为模块工作温度和存储范围。

表 26: 工作和存储温度范围

参数	最小	典型	最大	单位
正常工作温度 ¹⁾	-35	+25	+75	°C
扩展工作温度 ²⁾	-40		+85	°C
存储温度	-40		+90	°C

备注

- 1) 表示当模块在此温度范围工作时，模块的相关性能满足 3GPP 标准要求。
- 2) 表示当模块在此温度范围工作时，模块仍能保持正常工作状态，具备短信、数据传输等功能，不会出现不可恢复的故障；射频频谱、网络基本不受影响。仅个别指标如输出功率等参数的值可能会超出 3GPP 标准的范围。当温度返回至正常工作温度范围时，模块的各项指标仍符合 3GPP 标准。

5.3. 耗流

耗流值如下表所示。

表 27：模块耗流

参数	模式	描述	最小值	典型值	最大值	单位
I _V BAT	PSM	睡眠状态		3		uA
	Idle	空闲状态，DRX=2.56s, ECL0		0.5		mA
	Active @Single-tone (3.75kHz/15kHz)	射频发射状态， 23dBm (B1/B3)		250		mA
		射频发射状态， 23dBm (B8/B5/B20)		220		mA
		射频发射状态， 23dBm (B28)		280		mA
		射频发射状态， 12dBm (B1/B3/B8/B5/B20/B28)		130		mA
		射频发射状态， 0dBm (B1/B3/B8/B5/B20/B28)		70		mA
		射频接收状态		60		mA
	Active @Multi-tone (15kHz)	射频发射状态， 23dBm (B1/B3/B8/B5/B20/B28)		350		mA

5.4. 静电防护

在模块应用中，由于人体静电、微电子间带电摩擦等产生的静电，通过各种途径放电给模块，可能会

对模块造成一定的损坏，因此 ESD 防护应该受到重视。在研发、生产组装和测试等过程中，尤其在产品设计中，均应采取 ESD 防护措施。例如，在电路设计的接口处以及易受静电放电损伤或影响的点，应增加防静电保护；生产中应佩戴防静电手套等。

下表为模块引脚的 ESD 耐受电压情况。

表 28: ESD 性能参数（温度：25 °C，湿度：45 %）

测试点	接触放电	空气放电	单位
VBAT、GND	±5	±10	kV
天线接口	±5	±10	kV
其他接口	±0.5	±1	kV

6 机械尺寸

该章节描述了模块的机械尺寸，所有的尺寸单位为毫米；所有未标注公差尺寸，公差为 $\pm 0.05\text{mm}$ 。

6.1. 模块机械尺寸

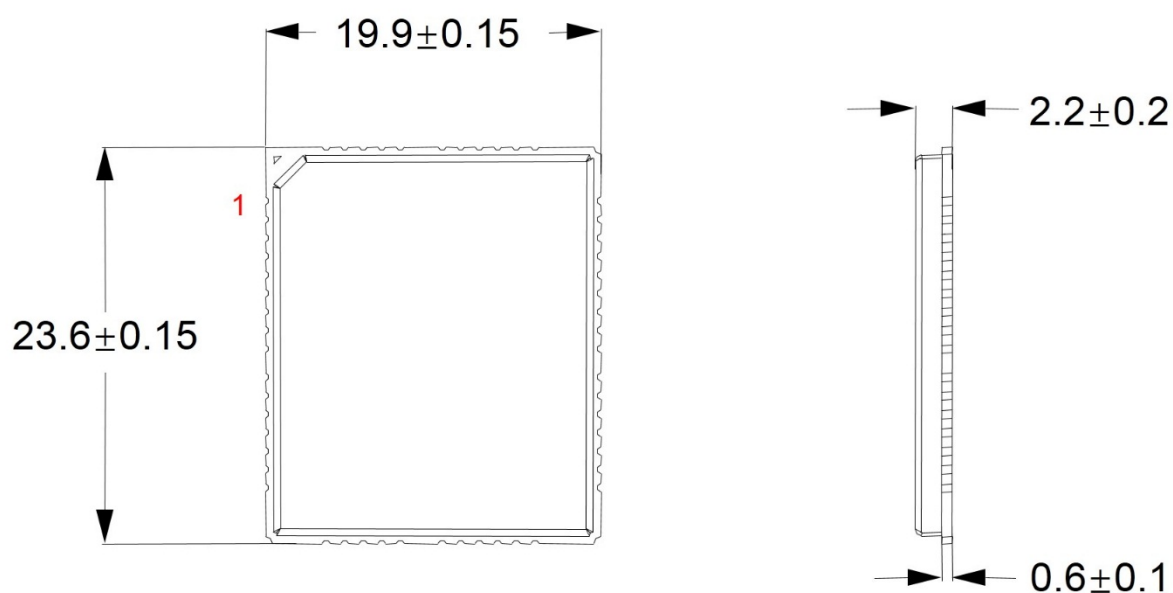


图 26：俯视及侧视尺寸图

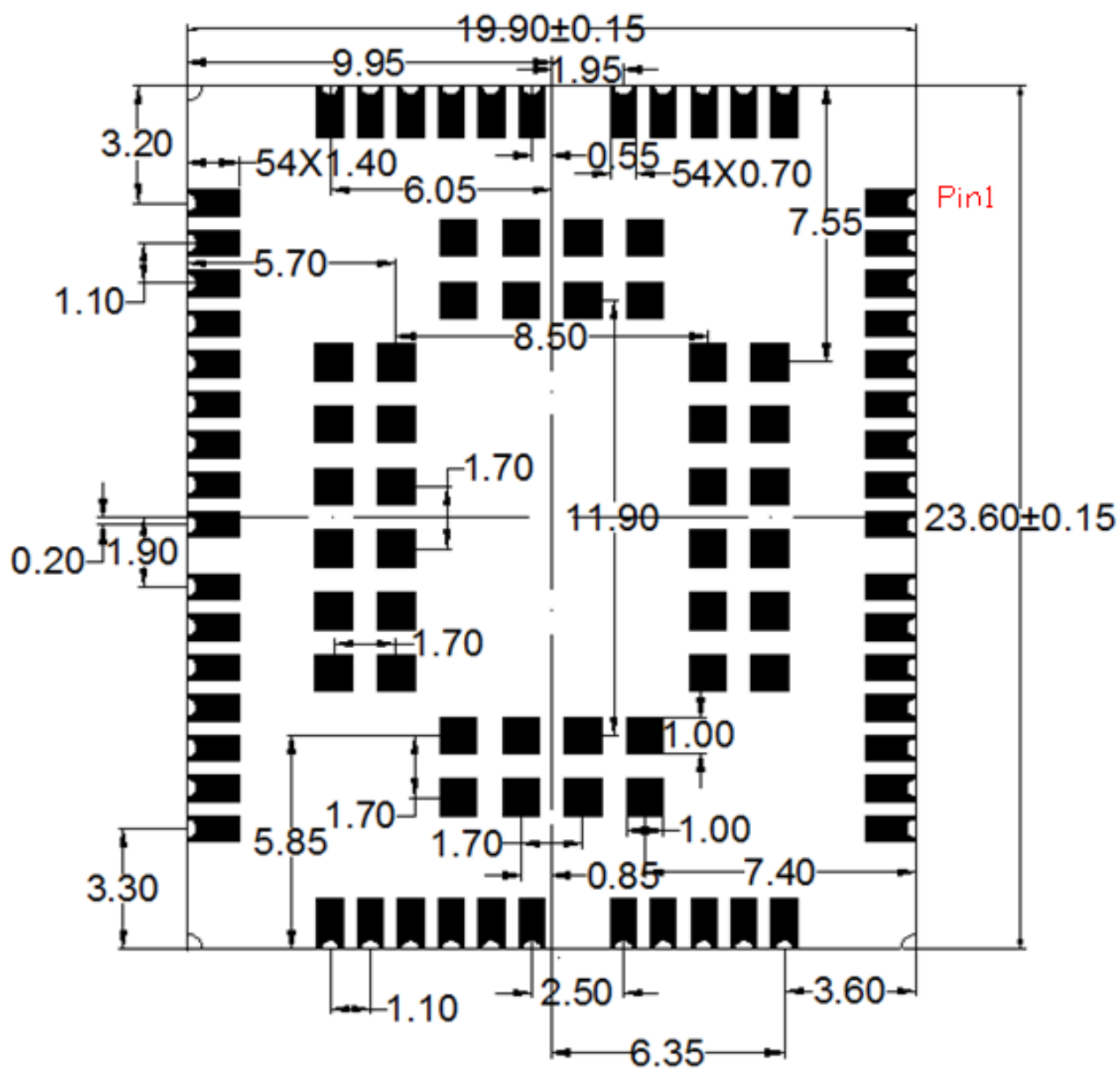


图 27: 底视尺寸图

6.2. 推荐封装

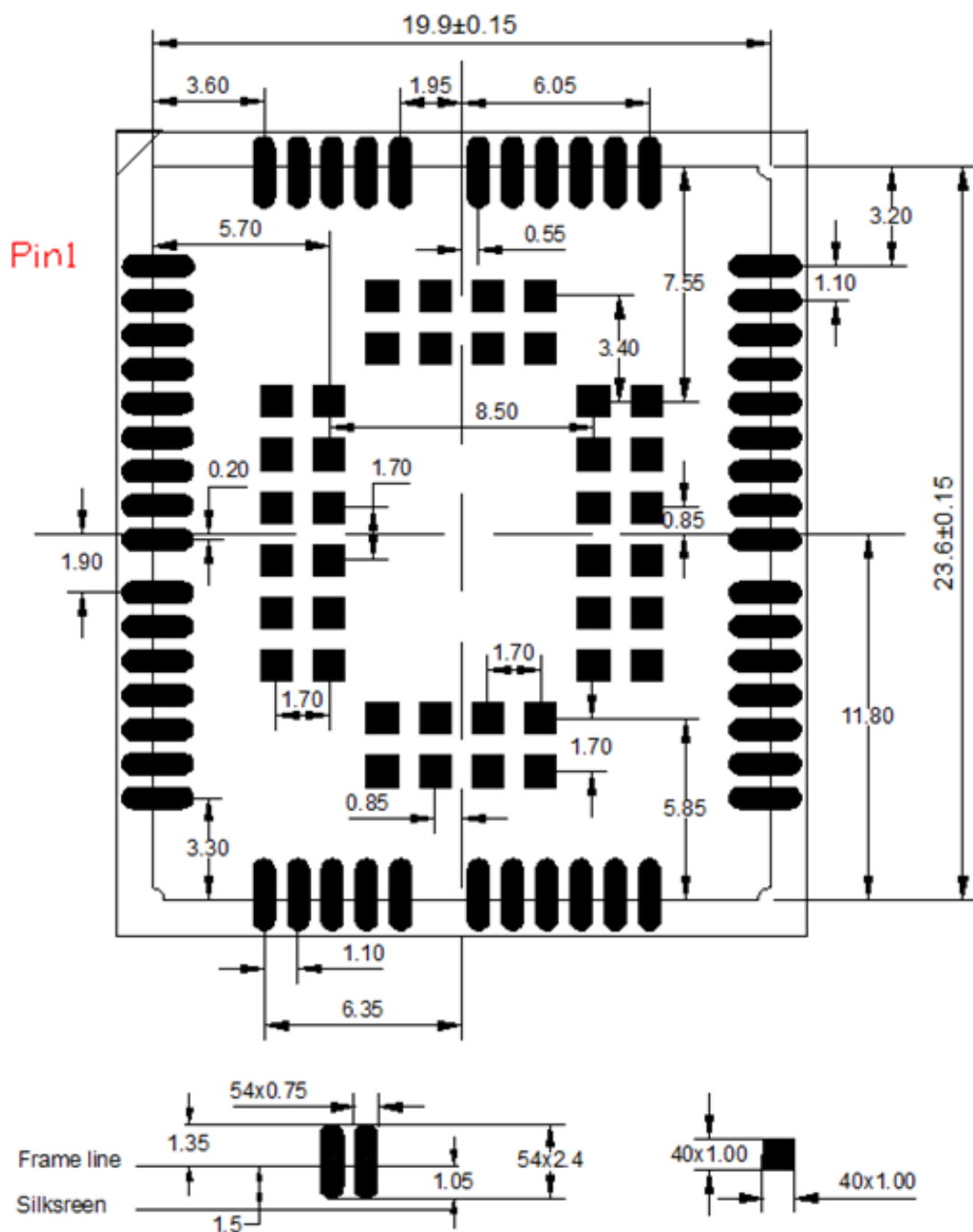


图 28: 推荐封装

备注

1. 为保证模块能够正常安装，PCB 板上模块和其他元器件之间至少保持 3mm 距离。
2. 所有的预留引脚不能连接到地。

6.3. 模块俯视图/底视图



图 29: 模块俯视图

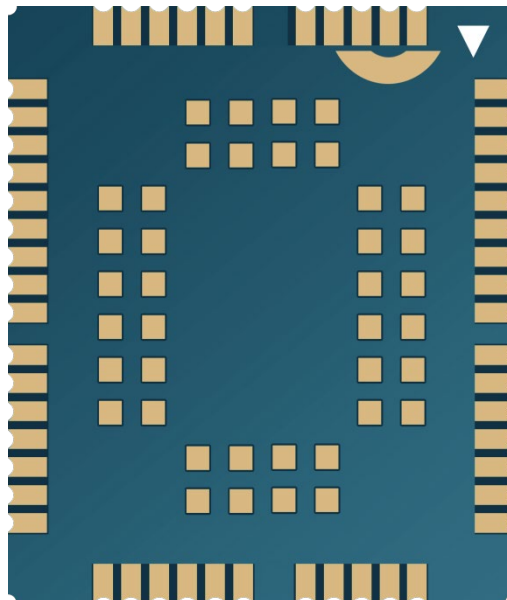


图 30: 模块底视图

备注

如上为 BC35-G-OpenCPU 模块的设计效果图，实际请参照移远通信的模块实物。

7 存储、生产和包装

7.1. 存储

BC35-G-OpenCPU 以真空密封袋的形式出货。模块的湿度敏感等级为 3（MSL 3），其存储需遵循如下条件：

1. 环境温度低于 40 摄氏度，空气湿度小于 90%的情况下，模块可在真空密封袋中存放 12 个月。
2. 当真空密封袋打开后，若满足以下条件，模块可直接进行回流焊或其它高温流程：
 - 模块存储空气湿度小于 10%。
 - 模块环境温度低于 30 摄氏度，空气湿度小于 60%，工厂在 168 小时以内完成贴片。
3. 若模块处于如下条件，需要在贴片前进行烘烤：
 - 当环境温度为 23 摄氏度（允许上下 5 摄氏度的波动）时，湿度指示卡显示湿度大于 10%。
 - 当真空密封袋打开后，模块环境温度低于 30 摄氏度，空气湿度小于 60%，但工厂未能在 168 小时以内完成贴片。
4. 如果模块需要烘烤，请在 120 摄氏度下（允许上下 5 摄氏度的波动）烘烤 8 小时。

备注

模块的包装无法承受高温烘烤。因此在模块烘烤之前，请移除模块包装。如果只需要短时间的烘烤，请参考 IPC/JEDECJ-STD-033 规范。

7.2. 生产焊接

用印刷刮板在网板上印刷锡膏，使锡膏通过网板开口漏印到 PCB 上，印刷刮板力度需调整合适。为保证模块印膏质量，模块焊盘部分对应的钢网厚度推荐为 0.18~0.20mm。详细信息请参考文档 [5]。

推荐的回流焊温度为 238°C~245°C，最高不能超过 245°C。为避免模块因反复受热而损坏，强烈推荐

客户在完成 PCB 板第一面的回流焊之后再贴模块。

推荐的炉温曲线图（无铅 SMT 回流焊）和相关参数如下图表所示：

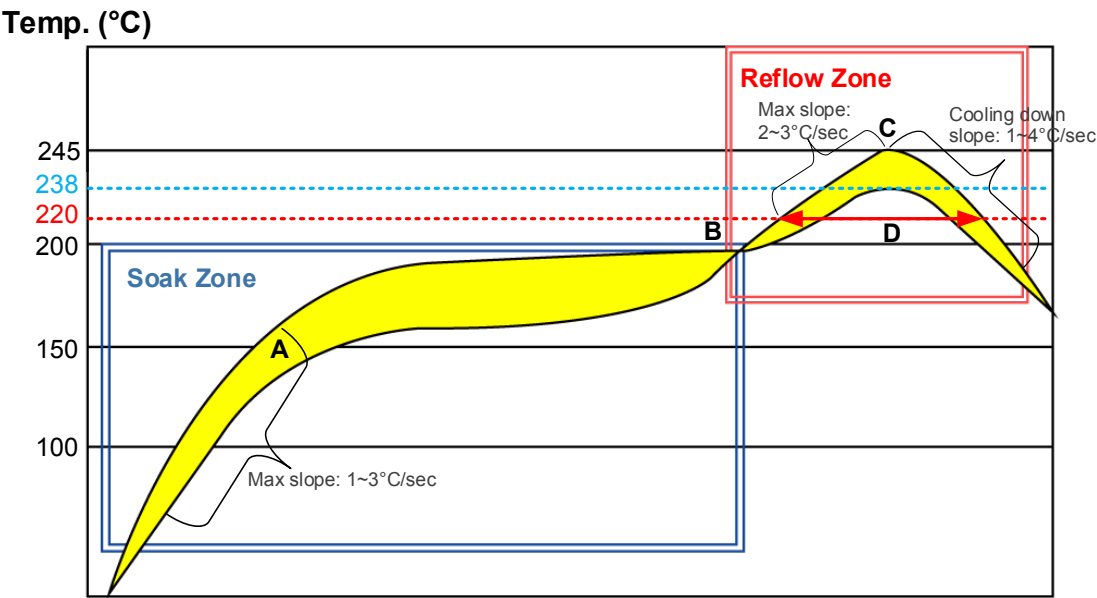


图 31：推荐的回流焊温度曲线

表 29：推荐的炉温测试控制要求

项目	推荐值
吸热区（Soak Zone）	
最大升温斜率	1°C/sec ~ 3°C/sec
恒温时间（A 和 B 之间的时间：150°C~200°C 期间）	60 sec ~ 120 sec
回流焊区（Reflow Zone）	
最大升温斜率	2°C/sec ~ 3°C/sec
回流时间（D：超过 220°C 的期间）	40 sec ~ 60 sec
最高温度	238°C ~ 245°C
冷却降温斜率	1°C/sec ~ 4°C/sec
回流次数	
最大回流次数	1 次

备注

1. 在生产焊接或者其他可能直接接触移远通信模块的过程中，不得使用任何有机溶剂（如酒精，异丙醇，丙酮，三氯乙烯等）擦拭模块屏蔽罩；否则可能会造成屏蔽罩生锈。
2. 移远通信洋白铜镭雕屏蔽罩可满足：12 小时中性盐雾测试后，镭雕信息清晰可辨识，二维码可扫描（可能会有白色锈蚀）。

7.3. 包装

BC35-G-OpenCPU 模块采用卷带包装，并用真空密封袋将其封装，直到模块准备焊接时才可以打开包装。每个卷带包含 250 个 BC35-G-OpenCPU 模块，卷盘直径为 330 毫米。具体规格如下：

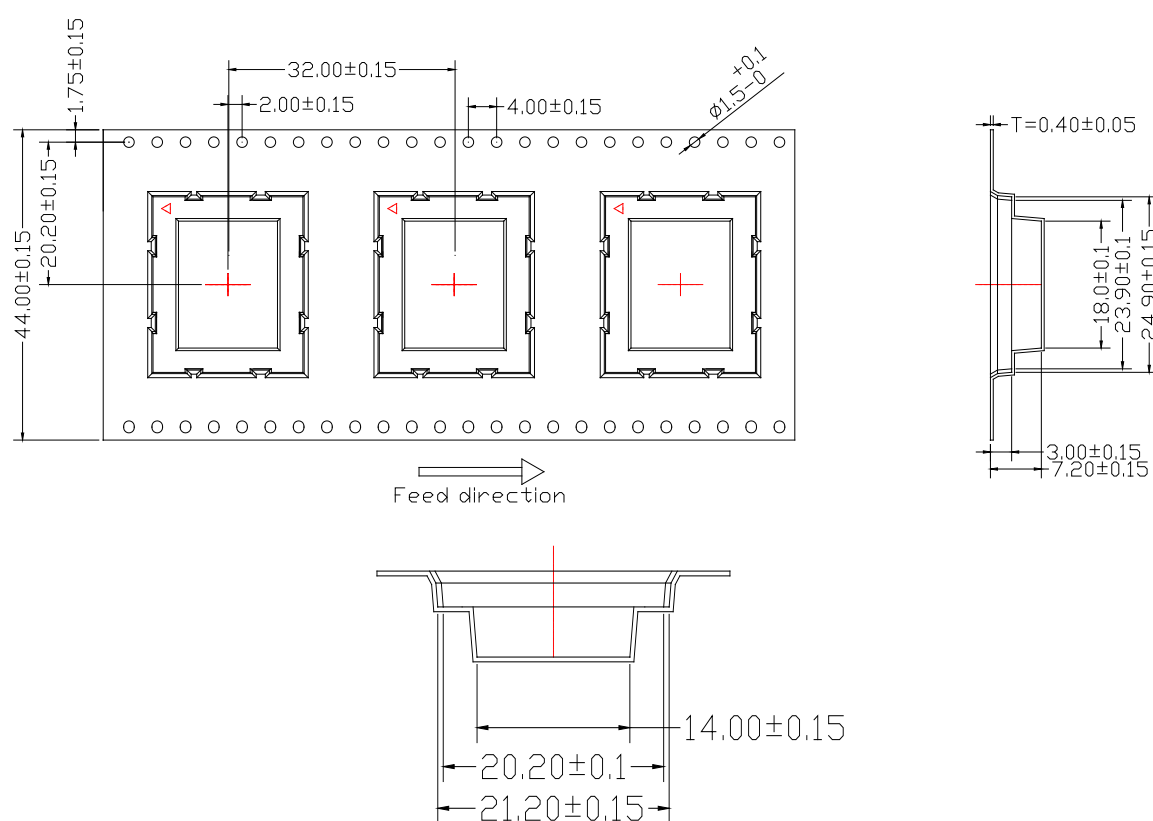


图 32：卷带尺寸（单位：毫米）

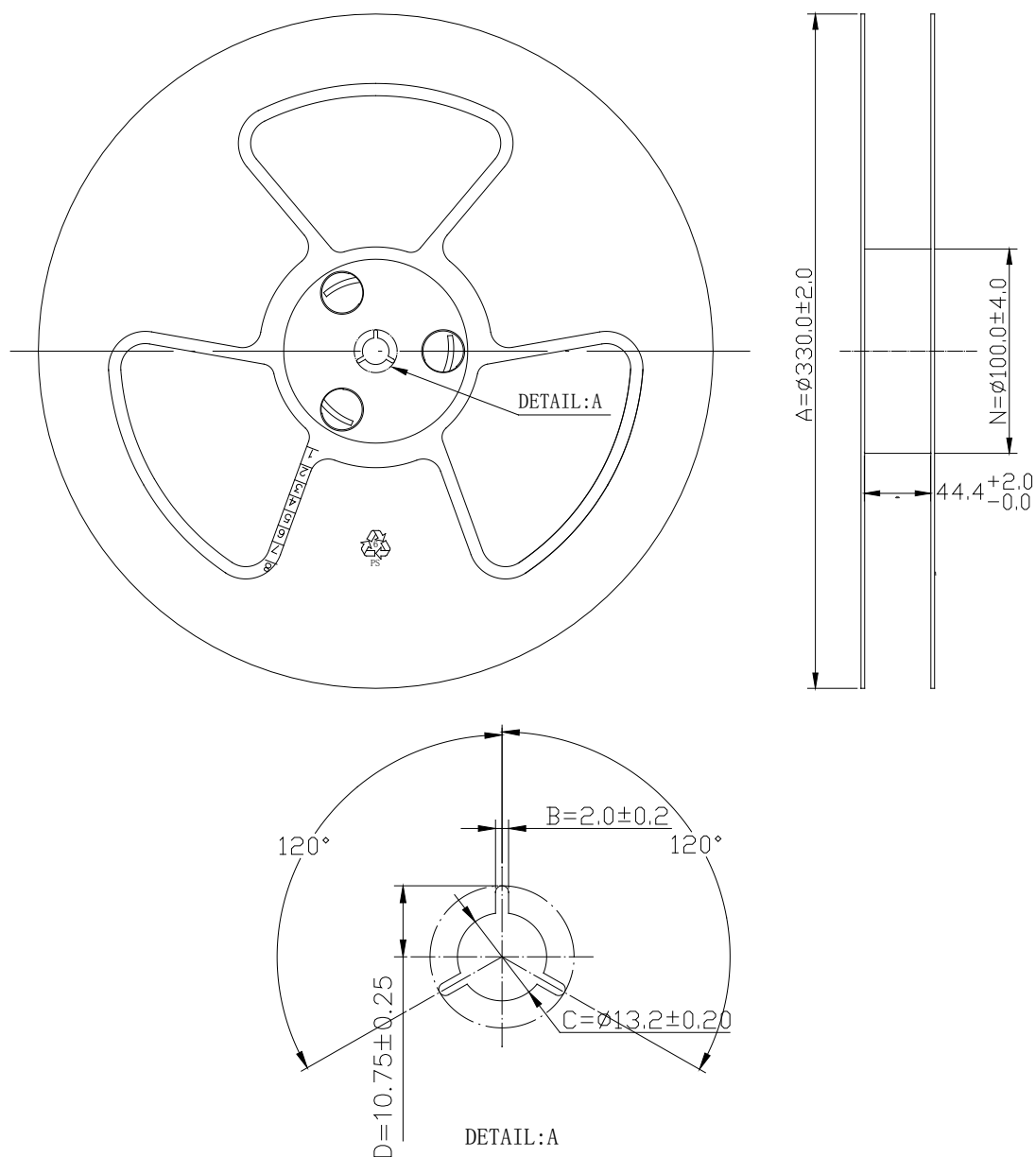


图 33: 卷盘尺寸 (单位: 毫米)

8 附录 A 参考文档及术语缩写

表 30：参考文档

序号	文档名称	备注
[1]	Quectel_BC35-G&BC28&BC95 R2.0_AT_Commands_Manual	BC35-G&BC28&BC95 R2.0 AT 命令使用手册
[2]	Quectel_BC35-G&BC28&BC95 R2.0_Firmware_Upgrade_User_Guide	BC35-G&BC28&BC95 R2.0 固件升级工具用户指导
[3]	Quectel_BC35-G&BC28&BC95 R2.0_UEMonitor_User_Guide	BC35-G&BC28&BC95 R2.0 UEMonitor 日志查看工具用户指导
[4]	Quectel_射频 LAYOUT_应用指导	Quectel 射频 LAYOUT 应用指导
[5]	移远通信模块贴片应用指导	移远通信模块贴片应用指导
[6]	Quectel_BC35-G-OpenCPU_User_Guide	BC35-G-OpenCPU 用户指导

表 31：术语缩写

缩写	描述
ADC	Analog-to-Digital Converter
DCE	Data Communications Equipment (typically module)
DTE	Data Terminal Equipment (typically computer, external controller)
DRX	Discontinuous Reception
ECL	Extended Coverage Level
H-FDD	Half Frequency Division Duplexing
I/O	Input/Output
IC	Integrated Circuit
I _{max}	Maximum Load Current
I _{norm}	Normal Current

kbps	Kilo Bits Per Second
LPWA	Low-Power Wide-Area
NB-IoT	Narrow Band Internet of Things
PCB	Printed Circuit Board
PSM	Power Saving Mode
PMU	Power Management Unit
RF	Radio Frequency
RoHS	Restriction of Hazardous Substances
RTC	Real Time Clock
RX	Receive Direction
USIM	Universal Subscriber Identification Module
SMS	Short Message Service
TAU	Tracking Area Update
TXD	Transmitting Data
UART	Universal Asynchronous Receiver & Transmitter
Vmax	Maximum Voltage Value
Vnorm	Normal Voltage Value
Vmin	Minimum Voltage Value
VIHmax	Maximum Input High Level Voltage Value
VIHmin	Minimum Input High Level Voltage Value
VILmax	Maximum Input Low Level Voltage Value
VILmin	Minimum Input Low Level Voltage Value
VImax	Absolute Maximum Input Voltage Value
VImin	Absolute Minimum Input Voltage Value
VOHmax	Maximum Output High Level Voltage Value

9 附录 B 复用引脚及其功能

表 32: 多路复用引脚及其功能

引脚号	引脚名称	默认功能配置	复用功能 1	复用功能 2	复用功能 3	驱动能力	电压域
1	SPI1_CS	SPI1_CS	GPIO	EINT	/	6mA	VDD_IO_L1 电压域
5	SPI1_MISO	SPI1_MISO	GPIO	EINT	/	6mA	
6	SPI1_CLK	SPI1_CLK	GPIO	EINT	/	6mA	
7	SPI1_MOSI	SPI1_MOSI	GPIO	EINT	/	6mA	
8	AUX_TXD	AUX_TXD	GPIO	EINT	/	6mA	
9	AUX_RXD	AUX_RXD	GPIO	EINT	/	6mA	
10	SPI2_CS	SPI2_CS	GPIO	EINT	/	6mA	
11	SPI2_MISO	SPI2_MISO	GPIO	EINT	/	6mA	
12	SPI2_CLK	SPI2_CLK	GPIO	EINT	/	6mA	
13	SPI2_MOSI	SPI2_MOSI	GPIO	EINT	/	6mA	

17	GPIO1	GPIO1	GPIO	EINT	/	6mA	
18	NETLIGHT	NETLIGHT	GPIO	EINT	PWM	6mA	
19	DBG_RXD	DBG_RXD	GPIO	EINT	/	6mA	
27	DTR	DTR	GPIO	EINT	/	6mA	
29	RXD	RXD	/	/	/	6mA	VDD_IO_R2 电压域
30	TXD	TXD	/	/	/	6mA	
31	CTS	CTS	GPIO	EINT	/	6mA	
32	RTS	RTS	GPIO	EINT	/	6mA	
34	RI	RI	GPIO	EINT	/	6mA	
35	I2C_SCL	I2C_SCL	GPIO	EINT	/	6mA	VDD_IO_L1 电压域
36	I2C_SDA	I2C_SDA	GPIO	EINT	/	6mA	
37	GPIO2	GPIO2	GPIO	EINT	/	6mA	VDD_IO_R2 电压域

备注

1. VDD_IO_R2 和 VDD_IO_L1 为内置 PMU 输出电压域，可通过软件函数开启，VDD_IO_R2 默认开启。详细请参考文档 [6]。
2. 主串口的 DTR、CTS 和 RTS 引脚功能正在开发中。